

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Low-voltage switchgear and controlgear –
Part 7-4: Ancillary equipment – PCB terminal blocks for copper conductors**

**Appareillage à basse tension –
Partie 7-4: Matériels accessoires – Blocs de jonction pour cartes de circuits
imprimés pour conducteurs en cuivre**





THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2013 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

Useful links:

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables you to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...).

It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available on-line and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) on-line.

Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Liens utiles:

Recherche de publications CEI - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée vous permet de trouver des publications CEI en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...).

Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

Just Published CEI - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) en ligne.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.



IEC 60947-7-4

Edition 1.0 2013-08

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Low-voltage switchgear and controlgear –
Part 7-4: Ancillary equipment – PCB terminal blocks for copper conductors**

**Appareillage à basse tension –
Partie 7-4: Matériels accessoires – Blocs de jonction pour cartes de circuits
imprimés pour conducteurs en cuivre**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

U

ICS 29.130.20

ISBN 978-2-8322-1029-1

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	4
INTRODUCTION.....	6
1 General	7
1.1 Scope.....	7
1.2 Normative references	7
2 Terms and definitions	9
3 Classification.....	10
4 Characteristics	10
4.1 Summary of characteristics	10
4.2 Type of PCB terminal block	10
4.3 Rated and limiting values	10
4.3.1 Rated voltages	10
4.3.2 Rated current	10
4.3.3 Standard cross-sections	10
4.3.4 Maximum cross-section	11
4.3.5 Connecting capacity	11
5 Product information	12
5.1 Marking	12
5.2 Additional information.....	13
6 Normal service, mounting and transport conditions.....	13
7 Constructional and performance requirements.....	13
7.1 Constructional requirements.....	13
7.1.1 Clamping units.....	13
7.1.2 Mounting and installation.....	14
7.1.3 Clearances and creepage distances	14
7.1.4 Terminal identification and marking	14
7.1.5 Resistance to abnormal heat and fire.....	15
7.1.6 Maximum cross-section and connecting capacity.....	15
7.2 Performance requirements	15
7.2.1 Temperature rise	15
7.2.2 Dielectric properties.....	15
7.2.3 Short-time withstand current.....	15
7.2.4 Contact resistance.....	16
7.2.5 Ageing test (climatic sequence and corrosion test)	16
7.3 Electromagnetic compatibility (EMC)	16
8 Tests.....	16
8.1 Kinds of test	16
8.2 General.....	16
8.3 Verification of mechanical characteristics	17
8.3.1 General	17
8.3.2 Attachment of the PCB terminal block on its support.....	17
8.3.3 Vacant.....	17
8.3.4 Verification of the maximum cross-section and connecting capacity.....	17
8.3.5 Verification of maximum cross-section (special test with gauges)	17
8.4 Verification of electrical characteristics.....	17
8.4.1 General	17

8.4.2	Verification of clearances and creepage distances.....	18
8.4.3	Dielectric tests.....	18
8.4.4	Verification of contact resistance	19
8.4.5	Temperature rise test	20
8.4.6	Short-time withstand current test	22
8.4.7	Ageing test (climatic sequence and corrosion test)	23
8.5	Verification of thermal characteristics	24
8.6	Verification of EMC characteristics	25
8.6.1	General	25
8.6.2	Immunity.....	25
8.6.3	Emission.....	25
Annex A (informative)	Structure of a PCB terminal block.....	26
Annex B (informative)	Additional Information to be specified between manufacturer and user	27
Annex C (informative)	Examples of PCBs and PCB terminal blocks for high current application	28
Bibliography		30
Figure 1	– Test assembly for the measurement of contact resistance and temperature rise	20
Figure 2	– Example of wiring structure of a multi-tier PCB terminal block	21
Figure 3	– Test assembly for the measurement of short-time withstand current.....	23
Figure 4	– Test sequence	24
Figure A.1	– Structure of a PCB terminal block	26
Figure C.1	– Structure of a high current PCB	28
Figure C.2	– PCB terminal block with soldered connection to the PCB	28
Figure C.3	– PCB terminal block with screwed connection to the PCB	29
Table 1	– Standard cross-sections of copper conductors	11
Table 2	– Relationship between maximum cross-section and connecting capacity of PCB terminal blocks.....	12
Table 3	– Standards for clamping units and connecting methods	14
Table 4	– Impulse withstand test voltages.....	19
Table 5	– Dielectric test voltages corresponding to the rated insulation voltage	19
Table 6	– Length of connectable conductors and conductor loops.....	21
Table 7	– Examples of cross-sectional distribution of interconnections on printed circuit boards	22

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR –

**Part 7-4: Ancillary equipment –
PCB terminal blocks for copper conductors**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60947-7-4 has been prepared by subcommittee 17B: Low-voltage switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
17B/1822/FDIS	17B/1827/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60947 series, published under the general title *Low-voltage switchgear and controlgear*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

This standard IEC 60947-7-4 for PCB terminal blocks covers not only the terminal block requirements according to IEC 60947-7 series but also takes into account the specifications of connectors according to IEC 61984 as the requirements for both components are highly similar due to equivalent applications.

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR –

Part 7-4: Ancillary equipment – PCB terminal blocks for copper conductors

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 60947 specifies requirements for PCB terminal blocks primarily intended for industrial or similar use.

Mounting and fixing on the printed circuit board is made by soldering, press-in or equivalent methods to provide electrical and mechanical connection between copper conductors and the printed circuit board.

This standard applies to PCB terminal blocks intended to connect copper conductors, with or without special preparation, having a cross-section between 0,05 mm² and 300 mm² (AWG 30/600 kcmil), intended to be used in circuits of a rated voltage not exceeding 1 000 V a.c. up to 1 000 Hz or 1 500 V d.c.

NOTE 1 Large cross section terminal blocks are dedicated to specific design of high current PCBs. The range up to 300 mm² is kept to cover any possible application. Examples of high current PCBs and PCB terminal blocks are shown in Annex C.

NOTE 2 AWG is the abbreviation of “American Wire Gage” (Gage (US) = Gauge (UK));

kcmil = 1 000 cmil;

1 cmil = 1 circular mil = surface of a circle having a diameter of 1 mil;

1 mil = 1/1 000 inch.

This standard may be used as a guide for special types of PCB terminal blocks with components, such as disconnect units, integrated cartridge fuse-links and the like.

If applicable, in this standard the term “clamping unit” is used instead of “terminal”. This is taken into account in case of references to IEC 60947-1.

1.2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-20, *Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test T: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads*

IEC 60352-1, *Solderless connections – Part 1: Wrapped connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60352-2, *Solderless connections – Part 2: Crimped connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60352-3, *Solderless connections – Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60352-4, *Solderless connections – Part 4: Solderless non-accessible insulation displacement connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60352-5, *Solderless connections – Part 5: Press-in connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60352-6, *Solderless connections – Part 6: Insulation piercing connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60352-7, *Solderless connections – Part 7: Spring clamp connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60512-2-1, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 2-1: Electrical continuity and contact resistance tests – Test 2a: Contact resistance – Millivolt level method*

IEC 60512-4-1, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 4-1: Voltage stress tests – Test 4a: Voltage proof*

IEC 60512-5-2, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 5-2: Current-carrying capacity tests – Test 5b: Current-temperature derating*

IEC 60512-11-7, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 11-7: Climatic tests – Test 11g: Flowing mixed gas corrosion test*

IEC 60512-11-9, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 11-9: Climatic tests – Test 11i: Dry heat*

IEC 60512-11-10, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 11-10: Climatic tests – Test 11j: Cold*

IEC 60695-2-11, *Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire flammability test method for end-products*

IEC 60695-2-12, *Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials*

IEC 60695-2-13, *Fire hazard testing – Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials*

IEC 60947-1:2007, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules*
Amendment 1: 2010

IEC 60998-2-3, *Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation-piercing clamping units*

IEC 60999-1, *Connecting devices – Electrical copper conductors – Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm² up to 35 mm² (included)*

IEC 60999-2, *Connecting devices – Electrical copper conductors – Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35 mm² up to 300 mm² (included)*

IEC 61210, *Connecting devices – Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors – Safety requirements*

ISO 6988, *Metallic and other non-organic coatings – Sulfur dioxide test with general condensation of moisture*

2 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60947-1, as well as the following, apply.

2.1

printed circuit board

PCB

piece of insulating material with fixed metal traces to connect electronic components

Note 1 to entry: Printed circuit boards are typically subdivided according to:

- their structure (e.g. single- and double-sided, multilayers);
- the nature of the base material (e.g. rigid, flexible).

2.2

PCB terminal block

part intended to be mounted on a printed circuit board and carrying one or more mutually insulated contact units and which provides an electrical and mechanical connection between copper conductor and printed circuit board

2.3

rated current

current value assigned by the manufacturer which the PCB terminal block can carry continuously (without interruption) and simultaneously through all its poles connected with the maximum cross-section, preferably at an ambient temperature of 40 °C, without the upper limiting temperature being exceeded

2.4

contact unit

conductive part establishing the connection between printed circuit board and connectable conductor(s)

Note 1 to entry: See Annex A.

2.5

upper limiting temperature

ULT

maximum temperature in the PCB terminal block as outcome (sum) of the ambient temperature and the temperature rise due to current flow, at which the PCB terminal block is intended to be still operable

Note 1 to entry: At ambient temperature = ULT the available temperature rise due to current flow is zero, thus the current carrying capacity of the PCB terminal block is zero.

2.6

lower limiting temperature

LLT

minimum temperature of a PCB terminal block assigned by the manufacturer, at which a PCB terminal block is intended to operate

3 Classification

A distinction is made between various types of PCB terminal blocks, if applicable, as follows:

- a) type of clamping unit (see 7.1.1);
- b) ability to accept prepared conductors (see 2.3.28 of IEC 60947-1:2007, Amendment 1 (2010));
- c) type of electrical contact to the printed circuit board;
- d) type of mechanical fastening to the printed circuit board;
- e) number of poles;
- f) pitch (center to center pin spacing);
- g) contact unit with identical or dissimilar clamping units;
- h) number of clamping units on each contact unit;
- i) service conditions.

4 Characteristics

4.1 Summary of characteristics

The characteristics of a PCB terminal block are as follows:

- type of PCB terminal block (see 4.2);
- rated and limiting values (see 4.3).

4.2 Type of PCB terminal block

The following shall be stated:

- type of clamping units (see 7.1.1);
- type of contacting on the printed circuit board;
- number of clamping units.

4.3 Rated and limiting values

4.3.1 Rated voltages

Subclauses 4.3.1.2 and 4.3.1.3 of IEC 60947-1:2007 apply.

4.3.2 Rated current

Verification of the rated current specified by the manufacturer is made according to 8.4.5.

If an ambient temperature other than 40 °C is used for the definition of the rated current, the manufacturer should state, in the technical documentation, the ambient temperature on which the rating is based, with reference, if appropriate, to the derating curve defined in IEC 60512-5-2, Test 5b.

The derating curve is obtained by applying a reduction factor of 0,8 according to IEC 60512-5-2, Test 5b. If another reduction factor is used, this shall be stated in the technical documentation.

4.3.3 Standard cross-sections

The standard values for cross-sections of copper conductors to be used are given in Table 1.

Table 1 – Standard cross-sections of copper conductors

Metric size ISO mm ²	Comparison between AWG/kcmil and metric sizes	
	Size	Equivalent metric area
	AWG/kcmil	mm ²
0,05	30	0,05
0,08	28	0,08
0,14	26	0,13
0,2	24	0,205
0,34	22	0,324
0,5	20	0,519
0,75	18	0,82
1	–	–
1,5	16	1,3
2,5	14	2,1
4	12	3,3
6	10	5,3
10	8	8,4
16	6	13,3
25	4	21,2
35	2	33,6
50	0	53,5
70	00	67,4
95	000	85
–	0000	107,2
120	250 (kcmil)	127
150	300 (kcmil)	152
185	350 (kcmil)	177
240	500 (kcmil)	253
300	600 (kcmil)	304

4.3.4 Maximum cross-section

The maximum cross-section shall be selected from the standard cross-sections given in Table 1.

4.3.5 Connecting capacity

For PCB terminal blocks with a maximum cross-section between 0,05 mm² and 35 mm² inclusive, the minimum range contained in Table 2 applies. The conductors may be rigid (solid or stranded) or flexible. The manufacturer shall state the types and the maximum and minimum cross-sections of conductors that can be connected and, if applicable, the number of conductors simultaneously connectable to each clamping unit. The manufacturer shall also state any necessary preparation of the end of the conductor.

**Table 2 – Relationship between maximum cross-section
and connecting capacity of PCB terminal blocks**

Maximum cross-section		Connecting capacity	
mm ²	AWG/kcmil	mm ²	AWG
0,05	30	0,05	30
0,08	28	0,05 – 0,08	30 – 28
0,14	26	0,05 – 0,08 – 0,14	30 – 28 – 26
0,2	24	0,08 – 0,14 – 0,2	28 – 26 – 24
0,34	22	0,14 – 0,2 – 0,34	26 – 24 – 22
0,5	20	0,2 – 0,34 – 0,5	24 – 22 – 20
0,75	18	0,34 – 0,5 – 0,75	22 – 20 – 18
1	–	0,5 – 0,75 – 1	–
1,5	16	0,75 – 1 – 1,5	20 – 18 – 16
2,5	14	1 – 1,5 – 2,5	18 – 16 – 14
4	12	1,5 – 2,5 – 4	16 – 14 – 12
6	10	2,5 – 4 – 6	14 – 12 – 10
10	8	4 – 6 – 10	12 – 10 – 8
16	6	6 – 10 – 16	10 – 8 – 6
25	4	10 – 16 – 25	8 – 6 – 4
35	2	16 – 25 – 35	6 – 4 – 2
50	0	25 – 35 – 50	4 – 2 – 0
70	00	35 – 50 – 70	2 – 0 – 00
95	000	50 – 70 – 95	0 – 00 – 000
–	0000	–	00 – 000 – 0000
120	250	70 – 95 – 120	000 – 0000 – 250
150	300	95 – 120 – 150	0000 – 250 – 300
185	350	120 – 150 – 185	250 – 300 – 350
–	400	–	300 – 350 – 400
240	500	150 – 185 – 240	350 – 400 – 500
300	600	185 – 240 – 300	400 – 500 – 600

5 Product information

5.1 Marking

A PCB terminal block shall be marked in a durable and legible manner with the following:

- the name of the manufacturer or a trade mark by which the manufacturer can be readily identified;
- a type reference permitting its identification in order to obtain relevant information from the manufacturer or his catalogue.

Very small PCB terminal blocks with a surface which cannot be marked shall be marked only according to a). In those cases all specified information shall be marked on the smallest packing unit.

5.2 Additional information

The following information shall be stated by the manufacturer, if applicable, e.g. in the manufacturer's data sheet or his catalogue or on the packing unit:

- a) IEC 60947-7-4, if the manufacturer claims compliance with this standard;
- b) the maximum cross-section;
- c) the connecting capacity, if different from Table 2, including the number of conductors simultaneously connectable;
- d) the rated current and the reduction factor to determine the derating curve if different from 0,8;

NOTE Unless otherwise specified, the rated current is preferably determined on four-pole contact units.

- e) the rated insulation voltage (U_i);
- f) the rated impulse withstand voltage (U_{imp}), when determined;
- g) service conditions, if different from those in Clause 6;
- h) special preparation of the end of the conductor.

6 Normal service, mounting and transport conditions

Clause 6 of IEC 60947-1:2007 applies.

7 Constructional and performance requirements

7.1 Constructional requirements

7.1.1 Clamping units

The clamping units shall allow the conductors to be connected by means ensuring that a reliable mechanical linkage and electrical contact is properly maintained.

No contact pressure shall be transmitted through insulating materials other than ceramic, or other material with characteristics not less suitable, unless there is sufficient resiliency in the metallic parts to compensate for any possible shrinkage of the insulating material.

The corresponding test is under consideration.

Clamping units and connecting methods listed in Table 3 fulfil the requirements of this standard.

Table 3 – Standards for clamping units and connecting methods

Ref.	Clamping units and connecting methods	Reference standards
a)	Screw-type clamping unit	IEC 60999-1 or IEC 60999-2
b)	Screwless-type clamping unit	IEC 60999-1 or IEC 60999-2 or IEC 60352-7
c)	Wrapped connection	IEC 60352-1
d)	Crimped connection	IEC 60352-2
e)	Insulation displacement connection (accessible)	IEC 60352-3 or IEC 60998-2-3
f)	Insulation displacement connection (non accessible)	IEC 60352-4 or IEC 60998-2-3
g)	Press-in connection	IEC 60352-5
h)	Insulation piercing connection	IEC 60352-6 or IEC 60998-2-3
i)	Flat quick-connect termination	IEC 61210
j)	Soldered connection	IEC 60068-2-20 ^a
^a The test method selected shall be stated in the test report.		
NOTE The relevant standard applies for the preconditioning of prepared conductors.		

7.1.2 Mounting and installation

PCB terminal blocks shall be so designed that safe mounting on a printed circuit board is possible by means of soldering, pressing-in, screwing, etc. The connection to the printed circuit board shall not be damaged by connecting the conductors.

Tests shall be made in accordance with 8.3.2.

7.1.3 Clearances and creepage distances

For PCB terminal blocks for which the manufacturer has stated values of rated impulse withstand voltage (U_{imp}) and rated insulation voltage (U_i), minimum values of clearances and creepage distances are given in Tables 13 and 15 of IEC 60947-1:2007, Amendment 1 (2010).

For PCB terminal blocks for which the manufacturer has not declared a value of rated impulse withstand voltage (U_{imp}), guidance for minimum values is given in Annex H of IEC 60947-1:2007.

Electrical requirements are given in 7.2.2.

7.1.4 Terminal identification and marking

Subclause 7.1.8.4 of IEC 60947-1:2007 applies with the following addition.

A PCB terminal block shall have provision, or at least space, for identification marks or numbers for each clamping unit or contact unit related to the circuit of which it forms a part except when such marking is not physically possible.

If such marking is not possible the information shall be stated by the manufacturer, e.g. in the manufacturer's data sheet or his catalogue or on the packing unit.

Such provision may consist of separate marking items, such as marking tags, identification labels, etc.

7.1.5 Resistance to abnormal heat and fire

The insulation materials of PCB terminal blocks shall not be adversely affected by abnormal heat and fire.

Compliance is checked by:

- a) the glow-wire test on the complete product according to 8.5 or
- b) verification of the insulating material in accordance with
 - 1) IEC 60695-2-12, method GWFI at a temperature of 850 °C or
 - 2) IEC 60695-2-13, method GWIT at a temperature of 775 °C.

This verification is not necessary for small parts (see IEC 60695-2-11).

NOTE 1 The relevant test method is specified by the manufacturer.

NOTE 2 For some applications it may be mandatory to check compliance by the glow-wire test on the complete product according to 8.5 only. The need is either defined in the end-product standard or by agreement between manufacturer and users. See B.1.

7.1.6 Maximum cross-section and connecting capacity

PCB terminal blocks shall be so designed that conductors of the maximum cross-section and the connecting capacity, if applicable, can be accepted.

Compliance is checked by the test described in 8.3.4.

The verification of the maximum cross-section may be performed by the special test according to 8.3.5.

7.2 Performance requirements

7.2.1 Temperature rise

PCB terminal blocks shall be tested in accordance with 8.4.5. The sum of ambient temperature and temperature rise of the PCB terminal block shall not exceed the upper limiting temperature (ULT).

7.2.2 Dielectric properties

If the manufacturer has declared a value of the rated impulse withstand voltage (U_{imp}) (see 4.3.1.3 of IEC 60947-1:2007), the requirements of 7.2.3 and 7.2.3.1 of IEC 60947-1:2007, Amendment 1 (2010) apply. If applicable, the impulse withstand voltage test shall be carried out in accordance with 8.4.3 a).

For the verification of solid insulation the power-frequency withstand voltage test shall be carried out in accordance with 8.4.3 b).

The verification of sufficient clearances and creepage distances shall be made in accordance with 8.4.2. For PCB terminal blocks for which the manufacturer has not declared a value of rated impulse withstand voltage (U_{imp}), guidance for minimum values is given in Annex H of IEC 60947-1:2007.

7.2.3 Short-time withstand current

A PCB terminal block shall be capable of withstanding the short-time withstand current which corresponds to 120 A/mm² for 1 s, in accordance with 8.4.6.

The test shall be performed using the smallest cross-section in the current path of the contact unit as declared by the manufacturer.

7.2.4 Contact resistance

When measured according to 8.4.4, the change in contact resistance of a PCB terminal block caused by the conductor connection and the mounting on the printed circuit board shall not exceed the permissible deviations.

7.2.5 Ageing test (climatic sequence and corrosion test)

For the verification of the resistance of connections against the influence of temperatures and corrosive atmospheres the climatic sequence test shall be carried out.

Compliance is checked by the test described in 8.4.7.

7.3 Electromagnetic compatibility (EMC)

Subclause 7.3 of IEC 60947-1:2007, Amendment 1 (2010) applies.

8 Tests

8.1 Kinds of test

Subclause 8.1.1 of IEC 60947-1:2007 applies with the following addition.

No routine tests are specified. The verification of the maximum cross-section according to 8.3.5 is a special test. All other tests are type tests.

8.2 General

Unless otherwise specified, PCB terminal blocks are tested in new and in clean condition, and installed as for normal use (see 6.3 of IEC 60947-1:2007) at an ambient temperature of $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$.

The tests are carried out in the order described in the subclauses.

Each test is carried out on new individual specimens with at least four contact units (one set) where each multipole PCB terminal block may contain the required number of contact units.

For a PCB terminal block family with the same design and comparable form, tests need only be performed on specimens representing the most unfavourable case.

The surface of the conductors shall be free of contamination and corrosion which degrades performance.

Care shall be taken when stripping conductors to avoid cutting, nicking, scraping or otherwise damaging the conductors.

In cases where the manufacturer has stated that special preparation of the end of the conductor is necessary, the test report shall indicate the method of preparation used.

The tests are carried out with the type of conductors (rigid or flexible) as stated by the manufacturer.

If one of the PCB terminal blocks does not withstand one of the tests, this test shall be repeated on a second set of PCB terminal blocks, all of which shall then comply with the

repeated test. If this test is part of a test sequence, the complete test sequence shall be repeated.

8.3 Verification of mechanical characteristics

8.3.1 General

The verification of mechanical characteristics includes the following test:

- attachment of the PCB terminal block on its support (see 8.3.2);
- verification of the maximum cross-section and connecting capacity (see 8.3.4);
- verification of maximum cross-section (special test with gauges) (see 8.3.5).

8.3.2 Attachment of the PCB terminal block on its support

The tests shall be carried out on the smallest number of poles, preferably two poles, of a PCB terminal block, which is mounted on an appropriate support (printed circuit board) as in normal use according to the manufacturer's instructions. For PCB terminal blocks to be soldered on printed circuit boards, this test shall be carried out on printed circuit boards with plated-through holes.

The wiring of the PCB terminal blocks for this test shall be carried out as shown in Figure 1 with the maximum cross-section as specified by the manufacturer.

After the verification of the contact resistance according to 8.4.4 this conductor shall be connected and disconnected five times according to the manufacturer's instructions. For each connection a new end of the conductor shall be used.

The tightening torque for PCB terminal blocks with screw-type clamping units shall be in accordance with Table 4 of IEC 60947-1:2007 or alternatively with a higher value as specified by the manufacturer.

At the end of the test the PCB terminal blocks shall comply with the contact resistance test according to 8.4.4. After the test the terminal assembly shall be free from damage which may impair further use.

8.3.3 Vacant

8.3.4 Verification of the maximum cross-section and connecting capacity

The verification of the maximum cross-section and connecting capacity shall be carried out according to the standard for clamping units to be used (see 7.1.1).

NOTE The mechanical properties of clamping units are tested according to the applicable connecting methods listed in Table 3.

8.3.5 Verification of maximum cross-section (special test with gauges)

Subclause 8.2.4.5 of IEC 60947-1:2007, Amendment 1 (2010) applies with the following addition.

The test shall be carried out on each clamping unit of one PCB terminal block.

8.4 Verification of electrical characteristics

8.4.1 General

The verification of electrical characteristics includes the following:

- verification of clearances and creepage distances (see 8.4.2);

- dielectric tests (see 8.4.3);
- verification of the contact resistance (see 8.4.4);
- temperature rise test (see 8.4.5);
- short-time withstand current test (see 8.4.6);
- ageing test (see 8.4.7).

8.4.2 Verification of clearances and creepage distances

8.4.2.1 General

The verification is made between two adjacent PCB terminal blocks or mutually insulated contact units of a multipole PCB terminal block and all live parts and accessible metal parts of a PCB terminal block.

The measurement of clearances and creepage distances shall be made under the following conditions:

- a) the PCB terminal blocks shall be connected with the most unfavourable conductor type(s) and conductor cross-section(s) among those declared by the manufacturer or without a conductor, if this turns out to be the most unfavourable case;
- b) the conductor ends shall be stripped, if required, to a length specified by the manufacturer.

The method of measuring clearances and creepage distances is described in annex G of IEC 60947-1:2007.

8.4.2.2 Clearances

The measured values of clearances shall be higher than the values given in Table 13 of IEC 60947-1:2007 for case B – homogeneous field (see 7.2.3.3 of IEC 60947-1:2007) based on the value of the rated impulse withstand voltage (U_{imp}) and the pollution degree stated by the manufacturer.

The impulse withstand voltage test shall be carried out in accordance with 8.4.3 a) unless the measured clearances are equal to or larger than the values given in Table 13 of IEC 60947-1:2007 for case A – inhomogeneous field (see 8.3.3.4.1, item 2), of IEC 60947-1:2007, Amendment 1 (2010)).

8.4.2.3 Creepage distances

The measured creepage distances shall be not less than the values given in Table 15 of IEC 60947-1:2007, Amendment 1 (2010) in connection with 7.2.3.4 a) and b) of IEC 60947-1:2007 based on the rated insulation voltage (U_i), the material group and the pollution degree as specified by the manufacturer.

8.4.3 Dielectric tests

- a) If the manufacturer has declared a value for the rated impulse withstand voltage (U_{imp}), the impulse withstand voltage test shall be carried out in accordance with Table 4.
- b) The power-frequency withstand verification of solid insulation according to IEC 60512-4-1 shall be made in accordance with the test voltages given in Table 5. For this test, the PCB terminal blocks are connected with the most unfavourable conductor (without a printed circuit board). The duration of the test is 1 min. The test voltage shall be applied between each of the poles which can assume different potentials in the application.

NOTE The relationship between nominal voltages and of the rated impulse withstand voltage (U_{imp}) are given in Annex H of IEC 60947-1:2007 (see also 7.1.3).

A voltage dip of the test voltage or a disruptive discharge or flashover is not allowed.

Table 4 – Impulse withstand test voltages

Rated impulse voltage	Impulse withstand voltage ^a	
	for a height of 2 000 m above sea level	at sea level
kV	kV (1,2/50 µs)	kV (1,2/50 µs)
0,5	0,5	0,55
0,8	0,8	0,91
1,5	1,5	1,75
2,5	2,5	2,95
4	4	4,8
6	6	7,3
8	8	9,8
12	12	14,8
^a If the testing laboratory is situated at a height between sea level and 2 000 m, interpolation of the impulse voltage is allowed.		

Table 5 – Dielectric test voltages corresponding to the rated insulation voltage

Rated insulation voltage	A.C. test voltage (r.m.s.) ^a	
	Overvoltage category III	Overvoltage category II
U_i	kV	kV
V	kV	kV
$U_i \leq 63$	0,5	0,4
$63 < U_i \leq 100$	0,8	0,5
$100 < U_i \leq 160$	1,4	0,8
$160 < U_i \leq 320$	2,2	1,4
$320 < U_i \leq 500$	3,1	2,2
$500 < U_i \leq 1\,000$	4,2	3,1
^a R.M.S. test voltages are based on 6.1.3.4 of IEC 60664-1:2007 and are higher than those of IEC 60947-1:2007, Table 12A in order to be in line with requirements of end-product standards.		

8.4.4 Verification of contact resistance

The contact resistance shall be verified:

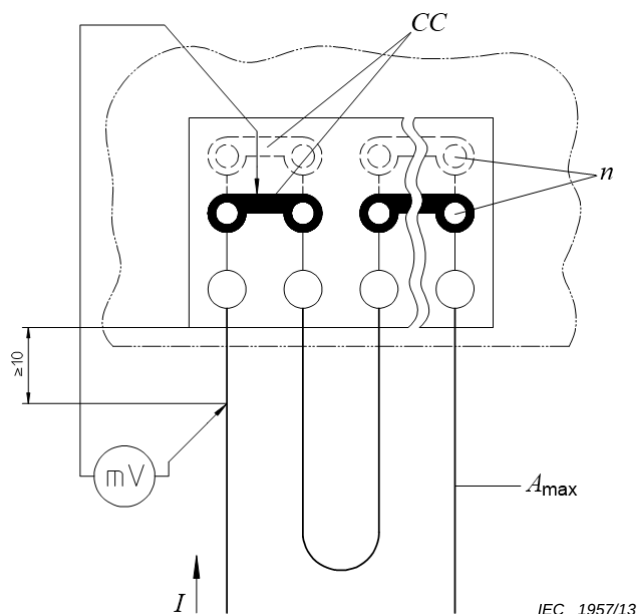
- before and after the test of attachment of the PCB terminal block on its support (see 8.3.2);
- before and after the temperature rise test (see 8.4.5);
- before and after the short-time withstand current test (see 8.4.6);
- before, during and after the ageing test (see 8.4.7).

The verification is made as specified in 8.3.2, 8.4.5, 8.4.6 and 8.4.7.

The contact resistance shall be measured between the connected conductor and the interconnection on the printed circuit board at each contact unit of a PCB terminal block as shown in Figure 1. The measurement is carried out according to the procedure specified in IEC 60512-2-1. After the tests a), b), c) and d) the contact resistance shall not rise by more than 50 % of the initial measurement value.

If the measurement value exceeds 1,5 times the initial measurement value, the clamping units and the connecting methods may be evaluated separately.

Dimensions in mm



Key

I	Test current
mV	Voltmeter
n	Number of connections to the printed circuit board per contact unit
CC	Trace on the printed circuit board for interconnection
$A_{\max}$	Maximum cross-section in mm ²

Figure 1 – Test assembly for the measurement of contact resistance and temperature rise

8.4.5 Temperature rise test

This test serves to evaluate the ability of the PCB terminal block to carry the rated current permanently without exceeding the upper limiting temperature (ULT). Unless otherwise specified, the test shall be carried out according to IEC 60512-5-2 under the following test conditions.

The test is carried out on an assembly of PCB terminal blocks mounted next to each other with preferably four contact units per level as shown in Figure 1 and Figure 2. The PCB terminal block shall be mounted on a printed circuit board as in normal use and connected in series with insulated conductors of the maximum cross-section and conductors on the printed circuit board. The interconnections on the printed circuit board shall be made with solid bare conductors of equal cross-section or comparable means and as short as possible.

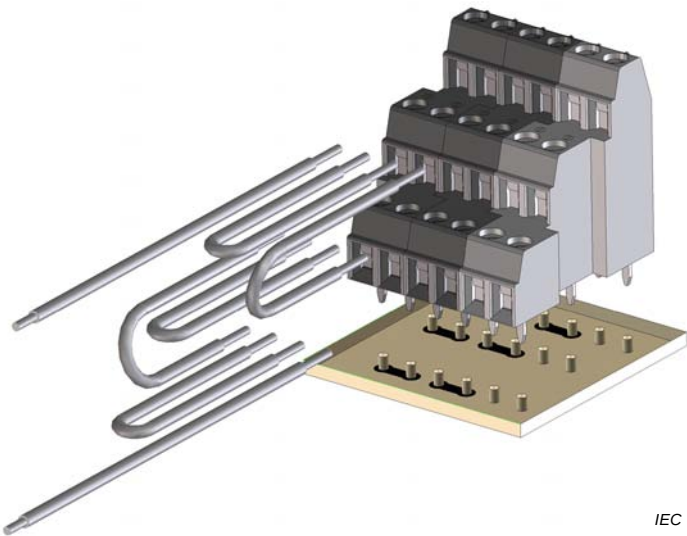


Figure 2 – Example of wiring structure of a multi-tier PCB terminal block

The tightening torque for PCB terminal blocks with screw-type clamping units shall be in accordance with Table 4 of IEC 60947-1:2007 or alternatively with a higher value as specified by the manufacturer.

The length of connectable conductors and conductor loops shall be taken from Table 6.

Table 6 – Length of connectable conductors and conductor loops

Cross-section mm ²	Length mm
≤ 10	500 ± 50
16 to 35	1 000 ± 100
> 35	2 000 ± 200

For PCB terminal blocks having/providing several connections to the printed circuit board the cross-section of interconnections A_B shall be calculated according to the following equation:

$$A_B \leq \frac{A_{\max}}{n}$$

where

A_B is the cross-section of interconnections in mm²

$A_{\max}$ the maximum cross-section in mm² and

n the number of connections to the printed circuit board per contact unit.

The sum of cross-sections of interconnections ($A_B \times n$) shall not exceed the cross-section of the connectable conductor. Examples are given in Table 7.

Table 7 – Examples of cross-sectional distribution of interconnections on printed circuit boards

Maximum cross-section ($A_{\max}$)	Number of connections to printed circuit board (n)			
	1	2	3	4
	Cross-section of interconnections (A_B)			
mm ²	mm ²			
...	...	...	...	...
2,5	2,5	1	0,75	0,5
4	4	1,5	1	1
6	6	2,5	1,5	1,5
10	10	4	2,5	2,5
...	...	...	...	...

The test assembly shall be prepared and arranged for the test procedure as shown in Figure 1 according to the test conditions described in IEC 60512-5-2, Test 5b. Unless otherwise specified, the size of the printed circuit board shall be selected so that it protrudes over the base area of the PCB terminal block on all sides corresponding to five times the spacing of the PCB terminal block. The printed circuit board that is used shall be described in the test report.

After verification of the contact resistance as described in 8.4.4, the test shall be carried out with single-phase alternating or direct current as described in IEC 60512-5-2, Test 5b.

As described in IEC 60512-5-2, the measuring points for measuring the temperature shall be located on the hottest spot above the printed circuit board (component side).

Where applicable it may be necessary to determine the hottest spot by carrying out pre-tests.

The reduction factor to determine the derating curve is 0,8. If this is not adhered to, the derating factor used shall be indicated in the technical documentation.

At the end of the test and after cooling down to ambient temperature the PCB terminal block shall comply with the contact resistance test according to 8.4.4 without modification of the assembly.

8.4.6 Short-time withstand current test

The purpose of this test is to verify the ability to withstand a thermal shock.

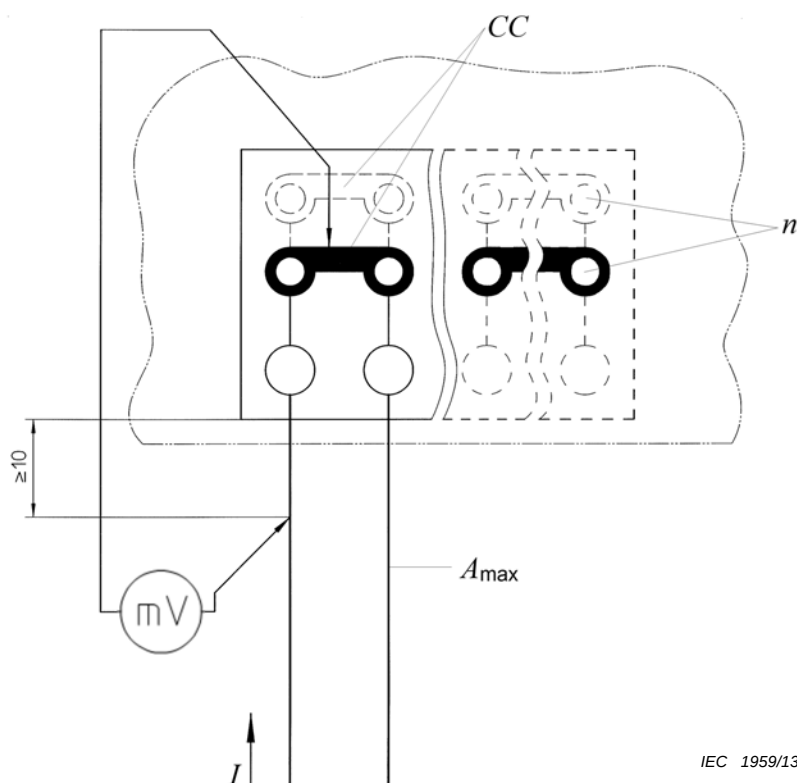
The test is carried out on two adjacent contact units with the longest and most unfavourable current paths of one PCB terminal block or two adjacent PCB terminal blocks. For this test, the PCB terminal block is mounted as in normal use according to the manufacturer's instructions and connected with conductors of maximum cross-section $A_{\max}$ and interconnections A_B as determined in 8.4.5 (see Figure 3).

The tightening torque for PCB terminal blocks with screw-type clamping units shall be in accordance with Table 4 of IEC 60947-1:2007 or alternatively with a higher value as specified by the manufacturer.

At the end of the test, the test (circuit) assembly shall show no interruptions and the PCB terminal blocks shall be free from cracks, ruptures or other critical damage.

After cooling down to room temperature the contact units shall comply with the contact resistance test according to 8.4.4.

Dimensions in mm



IEC 1959/13

Key

I	Test current
mV	Voltmeter
n	Number of connections to the printed circuit board per contact unit
CC	Trace on the printed circuit board for interconnection
$A_{\max}$	Maximum cross-section in mm ²

Figure 3 – Test assembly for the measurement of short-time withstand current

8.4.7 Ageing test (climatic sequence and corrosion test)

The purpose of this test is to verify that clamping units and connections to the printed circuit board are able to withstand environmental conditions and ageing.

The test sequence is carried out on a set of PCB terminal blocks each connected with conductors of the minimum and maximum cross-section. Attachment of the terminal block to the PCB shall be made according to the manufacturer's instructions.

The tests are carried out on prepared specimens in the indicated test sequence (see Figure 4).

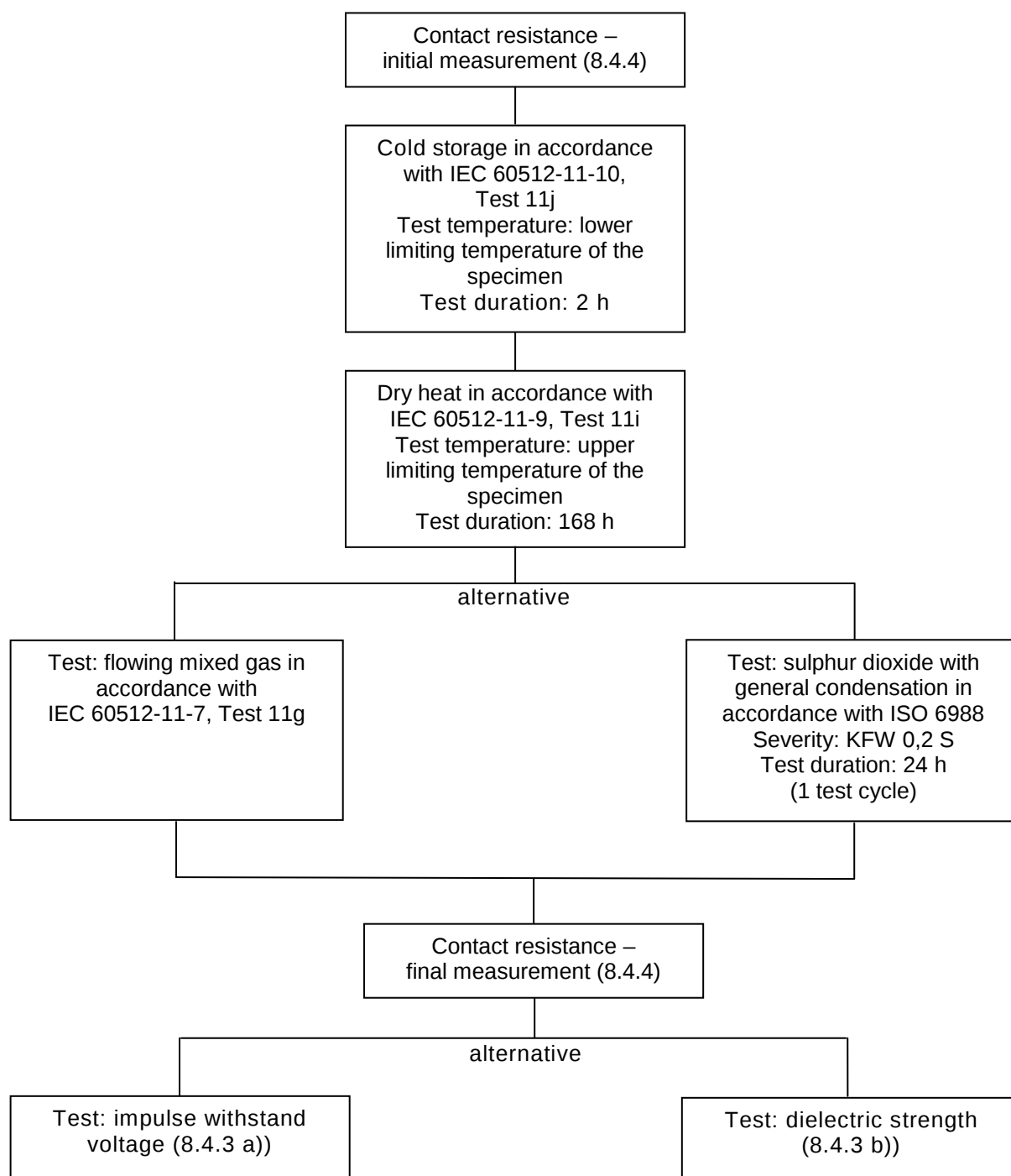


Figure 4 – Test sequence

IEC 1960/13

After each test step, except after the contact resistance measurement, the specimens shall be subjected to visual inspection where the PCB terminal blocks shall be free from cracks, ruptures or other critical damage.

8.5 Verification of thermal characteristics

The thermal characteristics are checked by the glow wire test.

NOTE The tests are not carried out on parts of ceramic material.

The test is carried out according to IEC 60695-2-10 under following conditions:

- on parts of insulating materials necessary to retain current-carrying parts in position and on parts of the protective conductor circuit at a test temperature of 850 °C;
- on parts of insulating materials necessary for the proper functioning of the PCB terminal block at a test temperature of 650 °C.

If the tests are to be made at more than one place on the same sample, it shall be ensured that any deterioration caused by previous tests does not affect the test to be made.

The test is carried out on a single specimen. In case of doubt the test shall be repeated on two other specimens which shall then comply with the repeated test.

The test is being carried out by applying the glow-wire for one time for 5 s with a tolerance of – 0/+1 s.

During the test, the specimen shall be placed in the most unfavourable position of normal use, with the surface to be tested in the vertical position. The tip of the glow-wire shall be applied to the specified surface of the specimen, taking account of the conditions of normal use, under which a heated or glowing object may be in contact with the specimen.

The test specimen is considered to have passed the glow-wire test if there is no flaming or glowing, or if all of the following situations apply:

- a) if flames or glowing of the test specimen extinguish within 30 s after removal of the glow-wire, i.e. $t_e \leq t_a + 30$ s; and
- b) when the specified layer of wrapping tissue is used there shall be no ignition of the wrapping tissue.

8.6 Verification of EMC characteristics

8.6.1 General

Subclause 8.4 of IEC 60947-1:2007 applies with the following addition.

8.6.2 Immunity

PCB terminal blocks within the scope of this standard are not sensitive to electromagnetic disturbances and therefore no immunity tests are necessary.

8.6.3 Emission

PCB terminal blocks within the scope of this standard do not generate electromagnetic disturbances and therefore no emission tests are necessary.

Annex A (informative)

Structure of a PCB terminal block

The structure of a PCB terminal block consists of an insulation body and one or more contact units (see also Figure A.1).

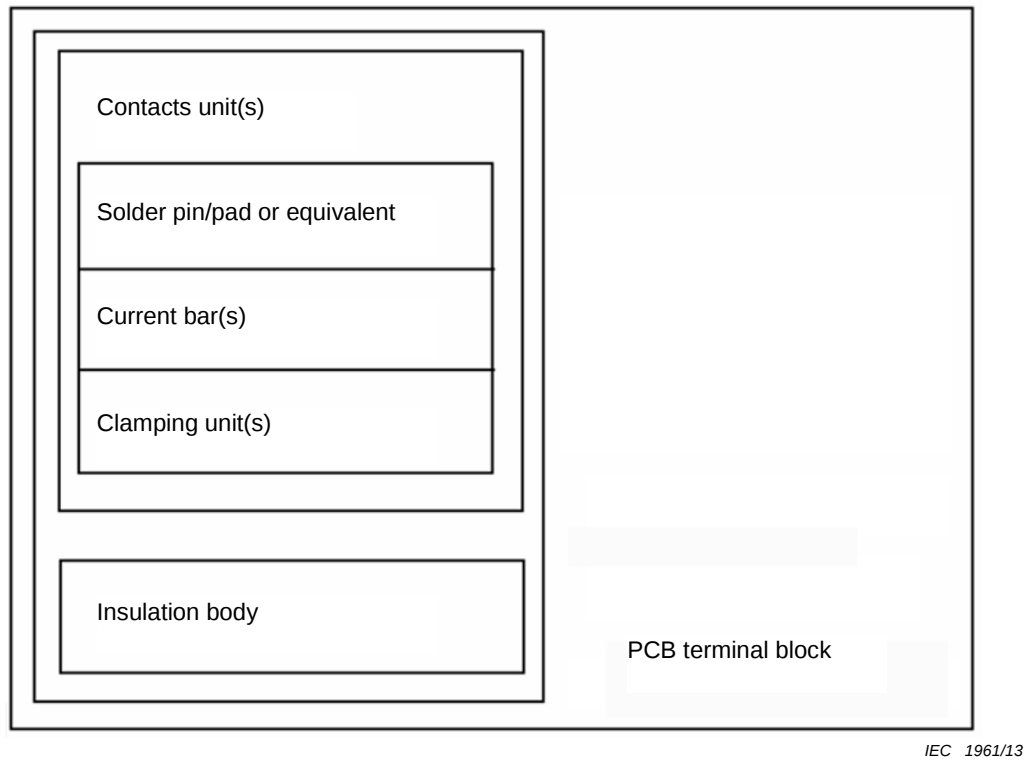


Figure A.1 – Structure of a PCB terminal block

Annex B

(informative)

Additional Information to be specified between manufacturer and user

B.1 Additional information available on request of the user

In addition to the product information as described in Clause 5, the following items are subject to agreement between manufacturer and user:

- additional derating curves according to IEC 60512-5-2, test 5b;
- glow-wire flammability test method for end-products according to IEC 60695-2-11;
- glow-wire flammability index (GWFI) of PCB terminal block materials according to IEC 60695-2-12;
- needle flame test according to IEC 60695-11-5;
- ball pressure test according to IEC 60695-10-2.

NOTE For the purpose of this annex, the word “agreement” is used in a very wide sense and the word “user” includes testing stations.

B.2 Information for testing additional to those mentioned above

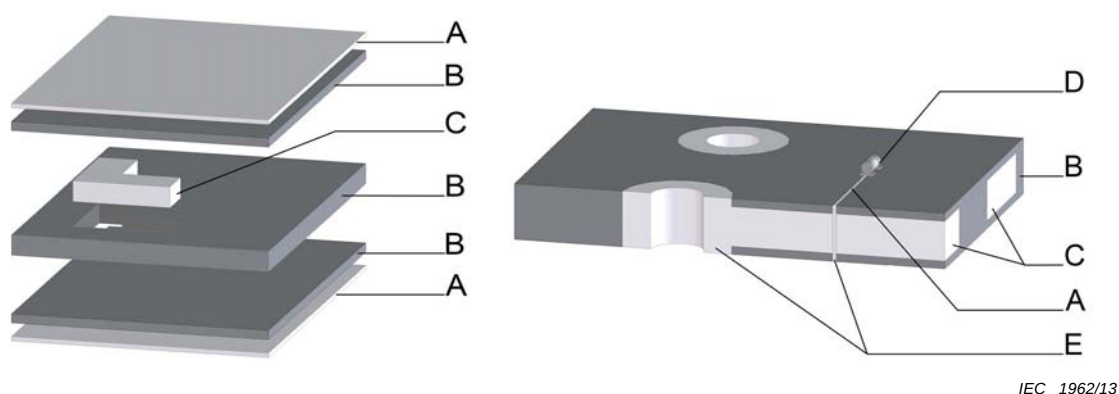
- Insulating material group (CTI value) of the insulating material.
It is recommended to check the insulating material group by the PTI value;
- Relevant detail specification, if available, for example loaded temperature according to IEC 60512-9-5, Test 9e;
- Tests for *T*-classified PCB terminal blocks according to IEC 60998-1:2002, Clause 12.

Annex C (informative)

Examples of PCBs and PCB terminal blocks for high current application

C.1 Layout of high current PCBs (schematic diagram)

The PCB terminal blocks for high current applications are commonly used in combination with suitable high current printed circuit boards (see Figure C.1). Possible connection methods to the PCB are soldering and screwing (see Figure C.2 and Figure C.3).

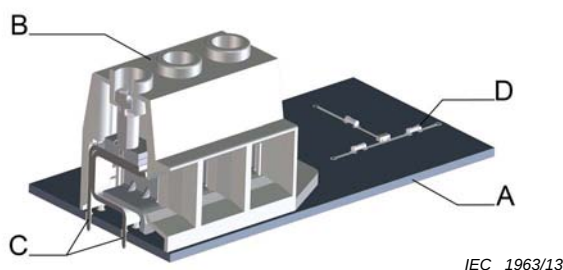


Key

- A conductive layer
- B base material
- C conductive inlay
- D SMD component
- E through connection

Figure C.1 – Structure of a high current PCB

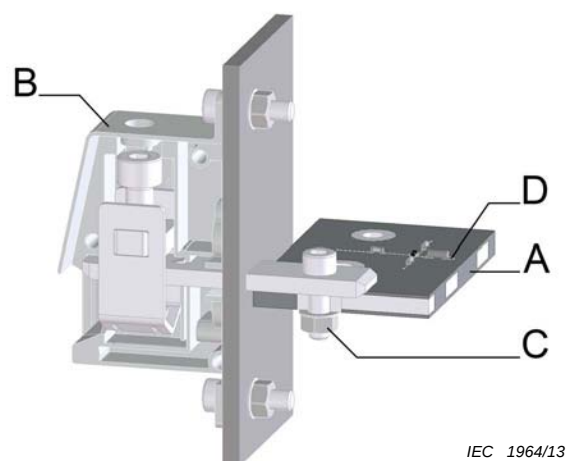
C.2 High current PCB terminal blocks



Key

- A PCB
- B PCB terminal block
- C connection according to 7.1.2
- D SMD component

Figure C.2 – PCB terminal block with soldered connection to the PCB

**Key**

- A PCB
- B PCB terminal block
- C connection according to 7.1.2
- D SMD component

Figure C.3 – PCB terminal block with screwed connection to the PCB

Bibliography

IEC 60512-5-1, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 5-1: Current-carrying capacity tests – Test 5a: Temperature rise*

IEC 60512-9-5, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 9-5: Endurance tests – Test 9e: Current loading, cyclic*

IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

IEC 60664-1:2007, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

IEC 60695-2-10, *Fire hazard testing – Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire apparatus and common test procedure*

IEC 60695-10-2, *Fire hazard testing – Part 10-2: Abnormal heat – Ball pressure test*

IEC 60695-11-5, *Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test method – Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance*

IEC 60998-1:2002, *Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 1: General requirements*

IEC 61984, *Connectors – Safety requirements and tests*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	34
INTRODUCTION	36
1 Généralités	37
1.1 Domaine d'application	37
1.2 Références normatives	37
2 Termes et définitions	39
3 Classification	40
4 Caractéristiques	40
4.1 Enumération des caractéristiques	40
4.2 Type du bloc de jonction pour carte de circuits imprimés	40
4.3 Valeurs assignées et valeurs limites	40
4.3.1 Tensions assignées	40
4.3.2 Courant assigné	40
4.3.3 Sections normales	41
4.3.4 Section maximale	41
4.3.5 Capacité de raccordement	42
5 Information sur le produit	42
5.1 Marquage	42
5.2 Informations complémentaires	43
6 Conditions normales de service, de montage et de transport	43
7 Exigences relatives à la construction et au fonctionnement	43
7.1 Exigences relatives à la construction	43
7.1.1 Organes de serrage	43
7.1.2 Montage et installation	44
7.1.3 Distances d'isolement et lignes de fuite	44
7.1.4 Identification et marquage des bornes	44
7.1.5 Résistance à la chaleur anormale et au feu	45
7.1.6 Section maximale et capacité de raccordement	45
7.2 Exigences relatives au fonctionnement	45
7.2.1 Echauffement	45
7.2.2 Propriétés diélectriques	45
7.2.3 Courant de courte durée admissible	45
7.2.4 Résistance de contact	46
7.2.5 Essai de vieillissement (essai de séquence climatique et de corrosion)	46
7.3 Compatibilité électromagnétique (CEM)	46
8 Essais	46
8.1 Types d'essai	46
8.2 Généralités	46
8.3 Vérification des caractéristiques mécaniques	47
8.3.1 Généralités	47
8.3.2 Tenue du bloc de jonction pour carte de circuits imprimés sur son support	47
8.3.3 Vide	47
8.3.4 Vérification de la section maximale et de la capacité de raccordement	47
8.3.5 Vérification de la section maximale (essai spécial avec calibres)	47

8.4	Vérification des caractéristiques électriques	48
8.4.1	Généralités	48
8.4.2	Vérification des distances d'isolement et des lignes de fuite	48
8.4.3	Essais diélectriques	48
8.4.4	Vérification de la résistance de contact	49
8.4.5	Essai d'échauffement	50
8.4.6	Essai de tenue au courant de courte durée admissible	52
8.4.7	Essai de vieillissement (séquence climatique et essai de corrosion)	53
8.5	Vérification des caractéristiques thermiques	54
8.6	Vérification des caractéristiques de CEM	55
8.6.1	Généralités	55
8.6.2	Immunité	55
8.6.3	Emission	55
Annexe A (informative) Structure d'un bloc de jonction pour carte de circuits imprimés		56
Annexe B (informative) Informations complémentaires à spécifier entre le fabricant et l'utilisateur		57
Annexe C (informative) Exemples de cartes de circuits imprimés et de blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés pour une application haute intensité		58
Bibliographie		60
Figure 1 – Montage d'essai pour la mesure de la résistance de contact et de l'échauffement		50
Figure 2 – Exemple de structure de câblage d'un bloc de jonction à plusieurs étages pour carte de circuits imprimés		51
Figure 3 – Montage d'essai pour la mesure du courant de courte durée admissible		53
Figure 4 – Séquence d'essai		54
Figure A.1 – Structure d'un bloc de jonction pour carte de circuits imprimés		56
Figure C.1 – Structure d'une carte de circuits imprimés haute intensité		58
Figure C.2 – Bloc de jonction pour carte de circuits imprimés avec connexion soudée à ladite carte		58
Figure C.3 – Bloc de jonction pour carte de circuits imprimés avec connexion vissée à ladite carte		59
Tableau 1 – Sections normales des conducteurs en cuivre		41
Tableau 2 – Relation entre la section maximale et la capacité de raccordement des blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés		42
Tableau 3 – Normes pour les organes de serrage et les méthodes de connexion		44
Tableau 4 – Tensions d'essai de tenue aux chocs		49
Tableau 5 – Tensions d'essai diélectrique correspondant à la tension assignée d'isolement		49
Tableau 6 – Longueur des conducteurs raccordables et des boucles de conducteurs		51
Tableau 7 – Exemples de répartition par section des interconnexions sur les cartes de circuits imprimés		52

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILLAGE À BASSE TENSION –

Partie 7-4: Matériels accessoires – Blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés pour conducteurs en cuivre

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60947-7-4 a été établie par le sous-comité 17B: Appareillage à basse tension, du comité d'études 17 de la CEI: Appareillage.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
17B/1822/FDIS	17B/1827/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60947, publiées sous le titre général *Appareillage à basse tension*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

La présente norme CEI 60947-7-4 relative aux blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés couvre non seulement les exigences y afférentes selon la série CEI 60947-7, mais tient également compte des spécifications des connecteurs selon la CEI 61984, dans la mesure où les exigences concernant ces deux composants sont fortement similaires en raison des applications équivalentes.

APPAREILLAGE À BASSE TENSION –

Partie 7-4: Matériels accessoires – Blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés pour conducteurs en cuivre

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60947 spécifie les exigences concernant les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés destinés principalement à un usage industriel ou similaire.

Le montage et la fixation sur la carte de circuits imprimés s'effectuent par brasage, insertion à force ou par des méthodes équivalentes afin d'assurer une connexion électrique et mécanique entre les conducteurs en cuivre et la carte de circuits imprimés.

La présente norme s'applique aux blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés destinés à connecter les conducteurs en cuivre, avec ou sans préparation spéciale, dont la section est comprise entre 0,05 mm² et 300 mm² (AWG 30/600 kcmil), destinés à être utilisés dans les circuits dont la tension assignée ne dépasse pas 1 000 V en courant alternatif jusqu'à 1 000 Hz ou 1 500 V en courant continu au maximum.

NOTE 1 Les blocs de jonction de section importante sont dédiés à un type spécifique de cartes de circuits imprimés haute intensité. La gamme couvrant jusqu'à 300 mm² au maximum est conservée pour couvrir toute application potentielle. Des exemples de cartes de circuits imprimés et de blocs de jonction haute intensité pour lesdites cartes sont présentés à l'Annexe C.

NOTE 2 AWG est l'abréviation de "American Wire Gage" (Gage (US) = Gauge (UK ou RU));

kcmil = 1 000 cmil;

1 cmil = 1 mil circulaire = surface d'un cercle ayant un diamètre de 1 mil;

1 mil = 1/1 000 pouce.

La présente norme peut servir de guide pour les types spéciaux de blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés comportant des composants tels que des unités de déconnexion, des éléments de remplacement à cartouche intégrés et analogues.

Dans la présente norme, le terme «organe de serrage» est utilisé, le cas échéant, à la place du terme «borne». Cela est pris en compte en cas de références à la CEI 60947-1.

1.2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60068-2-20, *Essais d'environnement – Partie 2-20: Essais – Essai T: Méthodes d'essai de la brasabilité et de la résistance à la chaleur de brasage des dispositifs à broches*

CEI 60352-1, *Connexions sans soudure – Partie 1: Connexions enroulées – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique*

CEI 60352-2, *Connexions sans soudure – Partie 2: Connexions serties – Exigences générales, méthodes d'essai et guide pratique*

CEI 60352-3, *Connexions sans soudure – Partie 3: Connexions autodénudantes accessibles sans soudure – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique*

CEI 60352-4, *Connexions sans soudure – Partie 4: Connexions autodénudantes non accessibles sans soudure – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique*

CEI 60352-5, *Connexions sans soudure – Partie 5: Connexions insérées à force – Exigences générales, méthodes d'essai et guide pratique*

CEI 60352-6, *Connexions sans soudure – Partie 6: Connexions à percement d'isolant – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique*

CEI 60352-7, *Connexions sans soudure – Partie 7: Connexions à ressort – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique*

CEI 60512-2-1, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 2-1: Essais de continuité électrique et de résistance de contact – Essai 2a: Résistance de contact – Méthode du niveau des millivolts*

CEI 60512-4-1, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 4-1: Essais de contrainte diélectrique – Essai 4a: Tension de tenue*

CEI 60512-5-2, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 5-2: Essais de courant limite – Essai 5b: Taux de réduction de l'intensité en fonction de la température*

CEI 60512-11-7, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 11-7: Essais climatiques – Essai 11g: Essai de corrosion dans un flux de mélange de gaz*

CEI 60512-11-9, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 11-9: Essais climatiques – Essai 11i: Chaleur sèche*

CEI 60512-11-10, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 11-10: Essais climatiques – Essai 11j: Froid*

CEI 60695-2-10, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-10: Essais au fil incandescent / chauffant – Appareillage et méthode commune d'essai*

CEI 60695-2-12, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-12: Essais au fil incandescent / chauffant – Méthode d'essai d'indice d'inflammabilité au fil incandescent (GWFI) pour matériaux*

CEI 60695-2-13, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-13: Essais au fil incandescent / chauffant – Méthode d'essai de température d'allumabilité au fil incandescent (GWIT) pour matériaux*

CEI 60947-1:2007, *Appareillage à basse tension – Partie 1: Règles générales*
Amendement 1:2010

CEI 60998-2-3, *Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue – Partie 2-3: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organes de serrage à perçage d'isolant*

CEI 60999-1, *Dispositifs de connexion – Conducteurs électriques en cuivre – Prescriptions de sécurité pour organes de serrage à vis et sans vis – Partie 1: Prescriptions générales et particulières pour les organes de serrage pour les conducteurs de 0,2 mm² à 35 mm² (inclus)*

CEI 60999-2, *Dispositifs de connexion – Conducteurs électriques en cuivre – Prescriptions de sécurité pour organes de serrage à vis et sans vis – Partie 2: Prescriptions particulières pour les organes de serrage pour conducteurs au-dessus de 35 mm² et jusqu'à 300 mm² (inclus)*

CEI 61210, *Dispositifs de connexion – Bornes plates à connexion rapide pour conducteurs électriques en cuivre – Exigences de sécurité*

ISO 6988, *Revêtements métalliques et autres revêtements non organiques – Essai au dioxyde de soufre avec condensation générale de l'humidité*

2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CEI 60947-1, ainsi que les suivants, s'appliquent.

2.1

carte de circuits imprimés

PCB

pièce de matériau isolant comportant des pistes métalliques fixes permettant la connexion des composants électroniques

Note 1 à l'article: Les cartes de circuits imprimés sont généralement sous-divisées selon:

- leur structure (par exemple simple et double faces, multicouche);
- la nature du matériau de base (par exemple rigide, souple).

2.2

bloc de jonction pour carte de circuits imprimés

partie destinée à être montée sur une carte de circuits imprimés et supportant une ou plusieurs unités de contact isolées entre elles, et qui fournit une connexion électrique et mécanique entre le conducteur en cuivre et la carte de circuits imprimés

2.3

courant assigné

valeur du courant assignée par le fabricant, que le bloc de jonction pour carte de circuits imprimés peut supporter en continu (sans interruption) et simultanément à travers tous ses contacts (pôles) connectés avec la section maximale, de préférence à une température ambiante de 40 °C, sans que la température limite supérieure ne soit dépassée

2.4

unité de contact

partie conductrice qui établit la connexion entre la carte de circuits imprimés et le(s) conducteur(s) raccordable(s)

Note 1 à l'article: Voir l'Annexe A.

2.5

température limite supérieure

ULT

température maximale dans le bloc de jonction pour carte de circuits imprimés comme résultat (somme) de la température ambiante et de l'échauffement dû à la circulation de courant, à laquelle le bloc de jonction pour carte de circuits imprimés est prévu pour encore fonctionner

Note 1 à l'article: A une température ambiante égale à la température limite supérieure, l'échauffement disponible dû à la circulation de courant est égal à zéro, et le courant limite admissible du bloc de jonction pour carte de circuits imprimés est par conséquent égal à zéro.

2.6

température limite inférieure

LLT

température minimale d'un bloc de jonction pour carte de circuits imprimés, assignée par le fabricant, à laquelle le bloc de jonction pour carte de circuits imprimés est prévu pour fonctionner

3 Classification

Une distinction entre les différents types de bloc de jonction pour carte de circuits imprimés est faite, le cas échéant, selon

- a) le type de l'organe de serrage (voir 7.1.1);
- b) la possibilité d'accepter des conducteurs préparés (voir 2.3.28 de la CEI 60947-1:2007, Amendement 1 (2010));
- c) le type de contact électrique avec la carte de circuits imprimés;
- d) le type de fixation mécanique avec la carte de circuits imprimés;
- e) le nombre de pôles;
- f) le pas (entraxe des broches);
- g) l'unité de contact avec des organes de serrage identiques ou différents;
- h) le nombre d'organes de serrage sur chaque unité de contact;
- i) les conditions de service.

4 Caractéristiques

4.1 Enumération des caractéristiques

Les caractéristiques d'un bloc de jonction pour carte de circuits imprimés sont celles qui suivent:

- le type du bloc de jonction pour carte de circuits imprimés (voir 4.2);
- les valeurs assignées et les valeurs limites (voir 4.3).

4.2 Type du bloc de jonction pour carte de circuits imprimés

Les informations suivantes doivent être indiquées:

- le type d'organes de serrage (voir 7.1.1);
- le type de contact sur la carte de circuits imprimés;
- le nombre d'organes de serrage.

4.3 Valeurs assignées et valeurs limites

4.3.1 Tensions assignées

Les paragraphes 4.3.1.2 et 4.3.1.3 de la CEI 60947-1:2007 s'appliquent.

4.3.2 Courant assigné

La vérification du courant assigné spécifié par le fabricant est faite selon 8.4.5.

Lorsqu'une température ambiante autre qu'une température de 40 °C est utilisée pour la définition du courant assigné, il convient que le fabricant indique, dans la documentation technique, la température ambiante sur laquelle le classement est établi, avec référence, le cas échéant, à la courbe de déclassement définie dans la CEI 60512-5-2, Essai 5b.

La courbe de déclassement est obtenue par application d'un facteur de réduction de 0,8 selon la CEI 60512-5-2, Essai 5b. La documentation technique doit indiquer toute utilisation d'un autre facteur de réduction.

4.3.3 Sections normales

Les valeurs normales des sections de conducteurs en cuivre à utiliser sont données dans le Tableau 1.

Tableau 1 – Sections normales des conducteurs en cuivre

Dimension du système métrique ISO	Comparaison entre les dimensions AWG/kcmil et celles du système métrique	
	Dimension	Section métrique équivalente
	AWG/kcmil	mm ²
mm ²		
0,05	30	0,05
0,08	28	0,08
0,14	26	0,13
0,2	24	0,205
0,34	22	0,324
0,5	20	0,519
0,75	18	0,82
1	–	–
1,5	16	1,3
2,5	14	2,1
4	12	3,3
6	10	5,3
10	8	8,4
16	6	13,3
25	4	21,2
35	2	33,6
50	0	53,5
70	00	67,4
95	000	85
–	0000	107,2
120	250 (kcmil)	127
150	300 (kcmil)	152
185	350 (kcmil)	177
240	500 (kcmil)	253
300	600 (kcmil)	304

4.3.4 Section maximale

La section maximale doit être choisie parmi les sections normales données dans le Tableau 1.

4.3.5 Capacité de raccordement

La gamme minimale du Tableau 2 s'applique aux blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés, de section maximale comprise entre 0,05 mm² et 35 mm² inclus. Les conducteurs peuvent être rigides (à âme massive ou à âme câblée) ou souples. Le fabricant doit indiquer les types et les sections maximales et minimales des conducteurs qui peuvent être raccordés ainsi que, le cas échéant, le nombre de conducteurs simultanément raccordables à chaque organe de serrage. Il doit aussi indiquer toute préparation qu'il serait nécessaire de faire subir à l'extrémité du conducteur.

Tableau 2 – Relation entre la section maximale et la capacité de raccordement des blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés

Section maximale		Capacité de raccordement	
mm ²	AWG/kcmil	mm ²	AWG
0,05	30	0,05	30
0,08	28	0,05 – 0,08	30 – 28
0,14	26	0,05 – 0,08 – 0,14	30 – 28 – 26
0,2	24	0,08 – 0,14 – 0,2	28 – 26 – 24
0,34	22	0,14 – 0,2 – 0,34	26 – 24 – 22
0,5	20	0,2 – 0,34 – 0,5	24 – 22 – 20
0,75	18	0,34 – 0,5 – 0,75	22 – 20 – 18
1	–	0,5 – 0,75 – 1	–
1,5	16	0,75 – 1 – 1,5	20 – 18 – 16
2,5	14	1 – 1,5 – 2,5	18 – 16 – 14
4	12	1,5 – 2,5 – 4	16 – 14 – 12
6	10	2,5 – 4 – 6	14 – 12 – 10
10	8	4 – 6 – 10	12 – 10 – 8
16	6	6 – 10 – 16	10 – 8 – 6
25	4	10 – 16 – 25	8 – 6 – 4
35	2	16 – 25 – 35	6 – 4 – 2
50	0	25 – 35 – 50	4 – 2 – 0
70	00	35 – 50 – 70	2 – 0 – 00
95	000	50 – 70 – 95	0 – 00 – 000
–	0000	–	00 – 000 – 0000
120	250	70 – 95 – 120	000 – 0000 – 250
150	300	95 – 120 – 150	0000 – 250 – 300
185	350	120 – 150 – 185	250 – 300 – 350
–	400	–	300 – 350 – 400
240	500	150 – 185 – 240	350 – 400 – 500
300	600	185 – 240 – 300	400 – 500 – 600

5 Information sur le produit

5.1 Marquage

Un bloc de jonction pour carte de circuits imprimés doit porter, de manière durable et lisible, ce qui suit:

- le nom du fabricant ou une marque de fabrique qui permette de l'identifier immédiatement;

- b) une référence de type permettant son identification dans le but d'obtenir tout renseignement correspondant auprès du fabricant ou dans son catalogue.

Les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés de très petites dimensions, dont la surface ne peut porter de marquage, doivent être marqués uniquement selon a). Dans ce type de cas, toutes les informations spécifiées doivent être marquées sur la plus petite unité de conditionnement.

5.2 Informations complémentaires

Les informations suivantes doivent être indiquées par le fabricant, le cas échéant, par exemple, dans la notice du fabricant ou dans son catalogue ou sur l'emballage:

- a) CEI 60947-7-4, si le fabricant déclare la conformité à la présente norme;
- b) la section maximale;
- c) la capacité de raccordement si elle diffère de celle du Tableau 2, ainsi que le nombre de conducteurs simultanément raccordables;
- d) le courant assigné, et le facteur de réduction permettant de déterminer la courbe de déclassement s'il est différent de 0,8;

NOTE Sauf spécification contraire, le courant assigné est déterminé de préférence sur les unités de contact à 4 pôles.

- e) la tension assignée d'isolement (U_i);
- f) la tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}), lorsqu'elle est déterminée;
- g) les conditions de service, si elles diffèrent de celles de l'Article 6;
- h) la préparation spéciale de l'extrémité du conducteur.

6 Conditions normales de service, de montage et de transport

L'Article 6 de la CEI 60947-1:2007 s'applique.

7 Exigences relatives à la construction et au fonctionnement

7.1 Exigences relatives à la construction

7.1.1 Organes de serrage

Les organes de serrage doivent permettre de raccorder les conducteurs par des moyens assurant qu'un contact mécanique et électrique fiable est correctement maintenu.

Aucune pression de contact ne doit être transmise par des matériaux isolants autres que la matière céramique ou autres matériaux présentant des caractéristiques au moins équivalentes, à moins que les parties métalliques ne possèdent une élasticité suffisante pour résister à tout rétrécissement possible du matériau isolant.

L'essai correspondant est à l'étude.

Les organes de serrage et méthodes de connexion énumérés dans le Tableau 3 satisfont aux exigences de la présente norme.

Tableau 3 – Normes pour les organes de serrage et les méthodes de connexion

Réf.	Organes de serrage et méthodes de connexion	Normes de référence
a)	Organe de serrage à vis	CEI 60999-1 ou CEI 60999-2
b)	Organe de serrage sans vis	CEI 60999-1 ou CEI 60999-2 ou CEI 60352-7
c)	Connexion enroulée	CEI 60352-1
d)	Connexion sertie	CEI 60352-2
e)	Connexion autodénudante (accessible)	CEI 60352-3 ou CEI 60998-2-3
f)	Connexion autodénudante (non accessible)	CEI 60352-4 ou CEI 60998-2-3
g)	Connexion insérée à force	CEI 60352-5
h)	Connexion à perçage d'isolant	CEI 60352-6 ou CEI 60998-2-3
i)	Borne plate à connexion rapide	CEI 61210
j)	Connexion brasée	CEI 60068-2-20 ^a
^a La méthode d'essai sélectionnée doit être mentionnée dans le rapport d'essai.		
NOTE La norme appropriée s'applique au préconditionnement des conducteurs préparés.		

7.1.2 Montage et installation

Les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés doivent être conçus de manière à pouvoir les monter en toute sécurité sur une carte de circuits imprimés par brasage, insertion à force, vissage, etc. La connexion à la carte de circuits imprimés ne doit pas être endommagée par l'opération de raccordement des conducteurs.

Les essais doivent être effectués conformément au 8.3.2.

7.1.3 Distances d'isolement et lignes de fuite

Pour les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés dont le fabricant a déclaré des valeurs de tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) et de tension assignée d'isolement (U_i), les valeurs minimales des distances d'isolement et des lignes de fuite sont données aux Tableaux 13 et 15 de la CEI 60947-1:2007, Amendement 1 (2010).

Pour les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés dont le fabricant n'a pas déclaré de valeur de tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}), l'Annexe H de la CEI 60947-1:2007 donne des recommandations pour les valeurs minimales.

Les exigences électriques sont données au 7.2.2.

7.1.4 Identification et marquage des bornes

Le paragraphe 7.1.8.4 de la CEI 60947-1:2007 s'applique avec le complément suivant.

Un bloc de jonction pour carte de circuits imprimés doit être prévu pour pouvoir porter des marques ou des nombres de repérage pour chaque organe de serrage ou unité de contact selon le circuit dont il fait partie, ou au moins comporter l'espace nécessaire à cet effet, sauf lorsque l'apposition d'un tel marquage n'est pas physiquement réalisable.

Lorsque ce type de marquage n'est pas possible, les informations doivent être indiquées par le fabricant, par exemple, dans la notice du fabricant ou dans son catalogue ou sur l'emballage.

On peut, par exemple, prévoir des marques séparées telles que languettes de marquage, étiquettes d'identification, etc.

7.1.5 Résistance à la chaleur anormale et au feu

Les matériaux isolants des blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés ne doivent pas être affectés par une chaleur anormale et par le feu.

La conformité est vérifiée par:

- a) l'essai au fil incandescent effectué sur le produit complet selon 8.5, ou
- b) la vérification du matériau isolant conformément à la
 - 1) CEI 60695-2-12, méthode GWFI à une température de 850 °C, ou
 - 2) CEI 60695-2-13, méthode GWIT à une température de 775 °C.

Cette vérification n'est pas nécessaire pour les petites pièces (voir la CEI 60695-2-11).

NOTE 1 La méthode d'essai appropriée est spécifiée par le fabricant.

NOTE 2 Pour certaines applications, il peut être obligatoire de vérifier la conformité par l'essai au fil incandescent sur le produit complet selon 8.5 uniquement. Ce besoin est défini soit dans la norme applicable au produit fini soit par accord entre le fabricant et les utilisateurs. Voir B.1.

7.1.6 Section maximale et capacité de raccordement

Les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés doivent être conçus de telle façon que des conducteurs de la section maximale et de la capacité de raccordement, le cas échéant, puissent être acceptés.

La conformité est vérifiée par l'essai décrit au 8.3.4.

La vérification de la section maximale peut être faite par l'essai spécial selon 8.3.5.

7.2 Exigences relatives au fonctionnement

7.2.1 Echauffement

Les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés doivent être soumis à essai conformément au 8.4.5. La somme de la température ambiante et de l'échauffement du bloc de jonction pour cartes de circuits imprimés ne doit pas dépasser la température limite supérieure (ULT).

7.2.2 Propriétés diélectriques

Si le fabricant a déclaré une valeur de tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) (voir 4.3.1.3 de la CEI 60947-1:2007), les exigences de 7.2.3 et 7.2.3.1 de la CEI 60947-1:2007, Amendement 1 (2010) s'appliquent. Le cas échéant, l'essai de tension de tenue aux chocs doit être effectué conformément au 8.4.3 a).

Pour la vérification de l'isolation solide, l'essai de tension de tenue à fréquence industrielle doit être effectué conformément au 8.4.3 b).

La vérification des distances d'isolement et des lignes de fuite suffisantes doit être faite conformément au 8.4.2. Pour les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés dont le fabricant n'a pas déclaré de valeur de tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}), l'Annexe H de la CEI 60947-1:2007 donne des recommandations pour les valeurs minimales.

7.2.3 Courant de courte durée admissible

Un bloc de jonction pour carte de circuits imprimés doit être capable de résister au courant de courte durée admissible qui correspond à 120 A/mm² pendant 1 s conformément au 8.4.6.

L'essai doit être réalisé en utilisant la section la plus petite du cheminement du courant de l'unité de contact, comme déclaré par le fabricant.

7.2.4 Résistance de contact

Lorsqu'il est mesuré selon 8.4.4, le changement de la résistance de contact d'un bloc de jonction pour carte de circuits imprimés provoqué par le raccordement des conducteurs et le montage sur la carte de circuits imprimés, ne doit pas excéder les écarts admissibles.

7.2.5 Essai de vieillissement (essai de séquence climatique et de corrosion)

L'essai de séquence climatique doit être effectué pour vérifier la résistance des connexions à l'influence des températures et des atmosphères corrosives.

La conformité est vérifiée par l'essai décrit au 8.4.7.

7.3 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Le paragraphe 7.3 de la CEI 60947-1:2007, Amendement 1 (2010) s'applique.

8 Essais

8.1 Types d'essai

Le paragraphe 8.1.1 de la CEI 60947-1:2007 s'applique avec le complément suivant.

Aucun essai individuel n'est spécifié. La vérification de la section maximale selon 8.3.5 est un essai spécial. Tous les autres essais sont des essais de type.

8.2 Généralités

Sauf spécification contraire, les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés sont soumis à essai neufs et propres, et installés comme en utilisation normale (voir 6.3 de la CEI 60947-1:2007) à une température ambiante de (25 ± 10) °C.

Les essais sont effectués dans l'ordre décrit dans les paragraphes.

Chaque essai est effectué sur de nouveaux échantillons individuels avec au moins quatre unités de contact (un lot) dans lesquelles chaque bloc de jonction pour carte de circuits imprimés multipôles peut contenir le nombre requis d'unités de contact.

Pour une famille de blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés de même conception et de forme comparable, les essais doivent être effectués uniquement sur les échantillons représentant le cas le plus défavorable.

La surface des conducteurs doit être exempte de contamination et de corrosion dégradant les performances.

Des précautions doivent être prises lors du dénudage des conducteurs afin d'éviter la coupure, l'ébréchure, le grattage ou autre dommage aux conducteurs.

Dans les cas où le fabricant a précisé qu'une préparation spéciale de l'extrémité du conducteur est nécessaire, le rapport d'essai doit indiquer la méthode de préparation utilisée.

Les essais sont effectués avec le type de conducteur (rigide ou souple) indiqué par le fabricant.

Si l'un des blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés ne satisfait pas à l'un des essais, cet essai doit être répété sur un deuxième lot de blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés qui doit alors satisfaire entièrement à l'essai répété. Si cet essai fait partie d'une séquence d'essais, la totalité de la séquence d'essais doit être répétée.

8.3 Vérification des caractéristiques mécaniques

8.3.1 Généralités

La vérification des caractéristiques mécaniques comprend les essais suivants:

- la tenue du bloc de jonction pour carte de circuits imprimés sur son support (voir 8.3.2);
- la vérification de la section maximale et de la capacité de raccordement (voir 8.3.4);
- la vérification de la section maximale (essai spécial avec calibres) (voir 8.3.5).

8.3.2 Tenue du bloc de jonction pour carte de circuits imprimés sur son support

Les essais doivent être effectués sur le plus petit nombre de pôles, de préférence deux pôles, d'un bloc de jonction pour carte de circuits imprimés, qui est monté sur un support approprié (carte de circuits imprimés) comme en utilisation normale selon les instructions du fabricant. Pour les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés destinés à être soudés sur des cartes de circuits imprimés, cet essai doit être effectué sur des cartes avec trous métallisés.

Le câblage des blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés pour cet essai doit être effectué tel qu'illustré à la Figure 1 avec la section maximale spécifiée par le fabricant.

Après la vérification de la résistance de contact selon 8.4.4, ce conducteur doit être connecté et déconnecté à cinq reprises selon les instructions du fabricant. Une extrémité de conducteur neuve doit être utilisée pour chaque connexion.

Le couple de serrage pour les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés avec organes de serrage à vis doit être conforme au Tableau 4 de la CEI 60947-1:2007 ou en variante à une valeur plus élevée, comme spécifié par le fabricant.

A la fin de l'essai, les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés doivent satisfaire à l'essai de résistance de contact selon 8.4.4. Après l'essai, l'ensemble de bornes doit être exempt de tout dommage susceptible de compromettre son emploi ultérieur.

8.3.3 Vide

8.3.4 Vérification de la section maximale et de la capacité de raccordement

La vérification de la section maximale et de la capacité de raccordement doit être effectuée selon la norme applicable aux organes de serrage à utiliser (voir 7.1.1).

NOTE Les propriétés mécaniques des organes de serrage sont soumises à essai selon les méthodes de connexion applicables énumérées dans le Tableau 3.

8.3.5 Vérification de la section maximale (essai spécial avec calibres)

Le paragraphe 8.2.4.5 de la CEI 60947-1:2007, Amendement 1 (2010) s'applique avec le complément suivant.

L'essai doit être effectué sur chaque organe de serrage d'un bloc de jonction pour carte de circuits imprimés.

8.4 Vérification des caractéristiques électriques

8.4.1 Généralités

La vérification des caractéristiques électriques comprend ce qui suit:

- la vérification des distances d'isolement et des lignes de fuite (voir 8.4.2);
- les essais diélectriques (voir 8.4.3);
- la vérification de la résistance de contact (voir 8.4.4);
- l'essai d'échauffement (voir 8.4.5);
- l'essai de tenue au courant de courte durée admissible (voir 8.4.6);
- l'essai de vieillissement (voir 8.4.7).

8.4.2 Vérification des distances d'isolement et des lignes de fuite

8.4.2.1 Généralités

La vérification est faite entre deux blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés adjacents ou deux unités de contact isolées entre elles d'un bloc de jonction multipôles et toutes les parties sous tension et parties métalliques accessibles d'un bloc de jonction pour cartes de circuits imprimés.

La mesure des distances d'isolement et des lignes de fuite doit être effectuée dans les conditions suivantes:

- a) les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés doivent être connectés avec le(s) type(s) et la (les) section(s) de conducteur les plus défavorables parmi ceux déclarés par le fabricant, ou sans conducteur, si ceci se révèle être le cas le plus défavorable;
- b) les extrémités des conducteurs doivent être dénudées, si nécessaire, à la longueur spécifiée par le fabricant.

La méthode de mesure des distances d'isolement et des lignes de fuite est décrite dans l'Annexe G de la CEI 60947-1:2007.

8.4.2.2 Distances d'isolement

Les valeurs mesurées des distances d'isolement doivent être supérieures aux valeurs données dans le Tableau 13 de la CEI 60947-1:2007 pour le cas B – champ homogène (voir 7.2.3.3 de la CEI 60947-1:2007) sur la base de la valeur de la tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) et du degré de pollution indiqués par le fabricant.

L'essai de tension de tenue aux chocs doit être effectué conformément à 8.4.3 a) à moins que les distances d'isolement mesurées soient égales ou supérieures aux valeurs données dans le Tableau 13 de la CEI 60947-1:2007 pour le cas A – champ non homogène (voir 8.3.3.4.1, point 2), de la CEI 60947-1:2007, Amendement 1 (2010)).

8.4.2.3 Lignes de fuite

Les lignes de fuite mesurées ne doivent pas être inférieures aux valeurs données dans le Tableau 15 de la CEI 60947-1:2007, Amendement 1 (2010) en rapport avec 7.2.3.4 a) et b) de la CEI 60947-1:2007 sur la base de la tension assignée d'isolement (U_i), du groupe de matériau et du degré de pollution spécifiés par le fabricant.

8.4.3 Essais diélectriques

- a) Si le fabricant a déclaré une valeur de tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}), l'essai de tension de tenue aux chocs doit être effectué conformément au Tableau 4.

- b) La vérification de la tenue à la fréquence industrielle de l'isolation solide selon la CEI 60512-4-1 doit être faite conformément aux tensions d'essai données dans le Tableau 5. Pour cet essai, les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés sont connectés avec le conducteur le plus défavorable (en l'absence de carte de circuits imprimés). La durée de l'essai est de 1 min. La tension d'essai doit être appliquée entre chacun des pôles qui peuvent supporter différents potentiels dans l'application.

NOTE La relation entre les tensions nominales et celle de la tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) sont indiquées dans l'Annexe H de la CEI 60947-1:2007 (Voir également 7.1.3).

Un creux de la tension d'essai, une décharge disruptive ou un contournement ne sont pas admis.

Tableau 4 – Tensions d'essai de tenue aux chocs

Tension assignée de tenue aux chocs	Tension de tenue aux chocs ^a	
	pour une hauteur de 2 000 m au dessus du niveau de la mer	au niveau de la mer
kV	kV (1,2/50 μ s)	kV (1,2/50 μ s)
0,5	0,5	0,55
0,8	0,8	0,91
1,5	1,5	1,75
2,5	2,5	2,95
4	4	4,8
6	6	7,3
8	8	9,8
12	12	14,8
^a Si le laboratoire d'essai est situé à une altitude comprise entre le niveau de la mer et 2 000 m, l'interpolation de la tension de choc est autorisée.		

Tableau 5 – Tensions d'essai diélectrique correspondant à la tension assignée d'isolement

Tension assignée d'isolement	Tension d'essai en courant alternatif (efficace) ^a	
	Catégorie de surtension III	Catégorie de surtension II
U_i	kV	kV
V		
$U_i \leq 63$	0,5	0,4
$63 < U_i \leq 100$	0,8	0,5
$100 < U_i \leq 160$	1,4	0,8
$160 < U_i \leq 320$	2,2	1,4
$320 < U_i \leq 500$	3,1	2,2
$500 < U_i \leq 1\,000$	4,2	3,1
^a Les tensions d'essai efficaces sont basées sur le 6.1.3.4 de la CEI 60664-1:2007 et sont plus élevées que celles données dans le Tableau 12A de la CEI 60947-1:2007, afin d'être conformes aux exigences des normes de produits finis.		

8.4.4 Vérification de la résistance de contact

La résistance de contact doit être vérifiée:

- a) avant et après l'essai de tenue du bloc de jonction pour carte de circuits imprimés sur son support (voir 8.3.2);

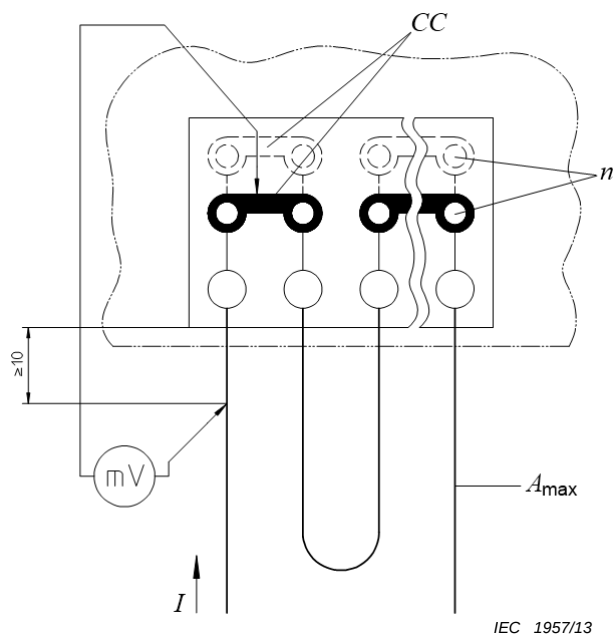
- b) avant et après l'essai d'échauffement (voir 8.4.5);
- c) avant et après l'essai de tenue au courant de courte durée admissible (voir 8.4.6);
- d) avant, pendant et après l'essai de vieillissement (voir 8.4.7).

La vérification est faite comme spécifié en 8.3.2, 8.4.5, 8.4.6 et 8.4.7.

La résistance de contact doit être mesurée entre le conducteur raccordé et l'interconnexion sur la carte de circuits imprimés à chaque unité de contact d'un bloc de jonction pour carte de circuits imprimés, comme l'illustre la Figure 1. La mesure est effectuée selon la procédure spécifiée dans la CEI 60512-2-1. Après les essais a), b), c) et d), la résistance de contact ne doit pas s'élever à plus de 50 % de la valeur de mesure initiale.

Si la valeur de mesure dépasse 1,5 fois la valeur de mesure initiale, les organes de serrage et les méthodes de raccordement peuvent être évalués séparément.

Dimensions en mm



Légende

I	Courant d'essai
mV	Voltmètre
n	Nombre de connexions à la carte de circuits imprimés par unité de contact
CC	Pistes sur la carte de circuits imprimés en vue d'une interconnexion
$A_{\max}$	Section maximale en mm ²

Figure 1 – Montage d'essai pour la mesure de la résistance de contact et de l'échauffement

8.4.5 Essai d'échauffement

Cet essai permet d'évaluer la capacité du bloc de jonction pour carte de circuits imprimés à supporter le courant assigné de façon permanente sans dépasser la température limite supérieure (ULT). Sauf spécification contraire, l'essai doit être effectué selon la CEI 60512-5-2 dans les conditions d'essai suivantes.

L'essai est effectué sur un ensemble de blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés montés côte à côte avec de préférence quatre unités de contact par niveau, comme l'illustrent la Figure 1 et la Figure 2. Le bloc de jonction pour carte de circuits imprimés doit être monté

sur une carte de circuits imprimés comme en utilisation normale et relié en série avec des conducteurs isolés de section maximale et des conducteurs placés sur la carte de circuits imprimés. Les interconnexions sur la carte de circuits imprimés doivent être réalisées avec des conducteurs nus à âme massive de section égale ou par des moyens comparables aussi courts que possible.

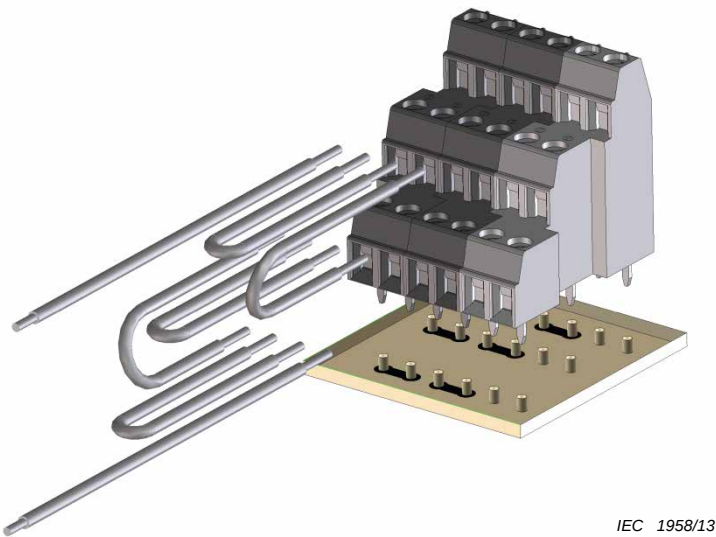


Figure 2 – Exemple de structure de câblage d'un bloc de jonction à plusieurs étages pour carte de circuits imprimés

Le couple de serrage pour les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés avec organes de serrage à vis doit être conforme au Tableau 4 de la CEI 60947-1:2007 ou en variante à une valeur plus élevée, comme spécifié par le fabricant.

La longueur des conducteurs raccordables et des boucles de conducteurs doit être celle indiquée dans le Tableau 6.

Tableau 6 – Longueur des conducteurs raccordables et des boucles de conducteurs

Section mm ²	Longueur mm
≤ 10	500 ± 50
16 à 35	1 000 ± 100
> 35	2 000 ± 200

Pour les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés comportant/fournissant plusieurs connexions à la carte de circuits imprimés, la section des interconnexions A_B doit être calculée selon l'équation suivante:

$$A_B \leq \frac{A_{\max}}{n}$$

où

A_B est la section des interconnexions en mm²

$A_{\max}$ est la section maximale en mm² et

n est le nombre de connexions à la carte de circuits imprimés par unité de contact.

La somme des sections d'interconnexions ($A_B \times n$) ne doit pas dépasser la section du conducteur raccordable. Des exemples sont donnés dans le Tableau 7.

Tableau 7 – Exemples de répartition par section des interconnexions sur les cartes de circuits imprimés

Section maximale ($A_{\max}$)	Nombre de connexions à la carte de circuits imprimés (n)			
	1	2	3	4
	Section des interconnexions (A_B)			
mm ²	mm ²			
...	...	...	...	...
2,5	2,5	1	0,75	0,5
4	4	1,5	1	1
6	6	2,5	1,5	1,5
10	10	4	2,5	2,5
...	...	...	...	...

Le montage d'essai doit être préparé et aménagé pour la procédure d'essai comme illustré à la Figure 1 selon les conditions d'essai décrites dans la CEI 60512-5-2, Essai 5b. Sauf spécification contraire, la dimension de la carte de circuits imprimés doit être choisie de sorte qu'elle dépasse sur la surface de base du bloc de jonction pour carte de circuits imprimés sur tous les côtés correspondant à cinq fois l'espacement dudit bloc. La carte de circuits imprimés utilisée doit être décrite dans le rapport d'essai.

Après vérification de la résistance de contact comme décrit en 8.4.4, l'essai doit être effectué avec un courant alternatif ou continu monophasé tel que décrit dans la CEI 60512-5-2, Essai 5b.

Comme décrit dans la CEI 60512-5-2, les points de mesure de la température doivent être situés sur le point le plus chaud au-dessus de la carte de circuits imprimés (face composants).

Le cas échéant, il peut être nécessaire de déterminer le point le plus chaud en effectuant des essais préliminaires.

Le facteur de réduction permettant de déterminer la courbe de déclassement est égal à 0,8. Si ceci n'est pas respecté, le facteur de déclassement utilisé doit être indiqué dans la documentation technique.

A la fin de l'essai et après refroidissement à la température ambiante, le bloc de jonction pour carte de circuits imprimés doit satisfaire à l'essai de résistance de contact selon 8.4.4 sans modification dudit montage.

8.4.6 Essai de tenue au courant de courte durée admissible

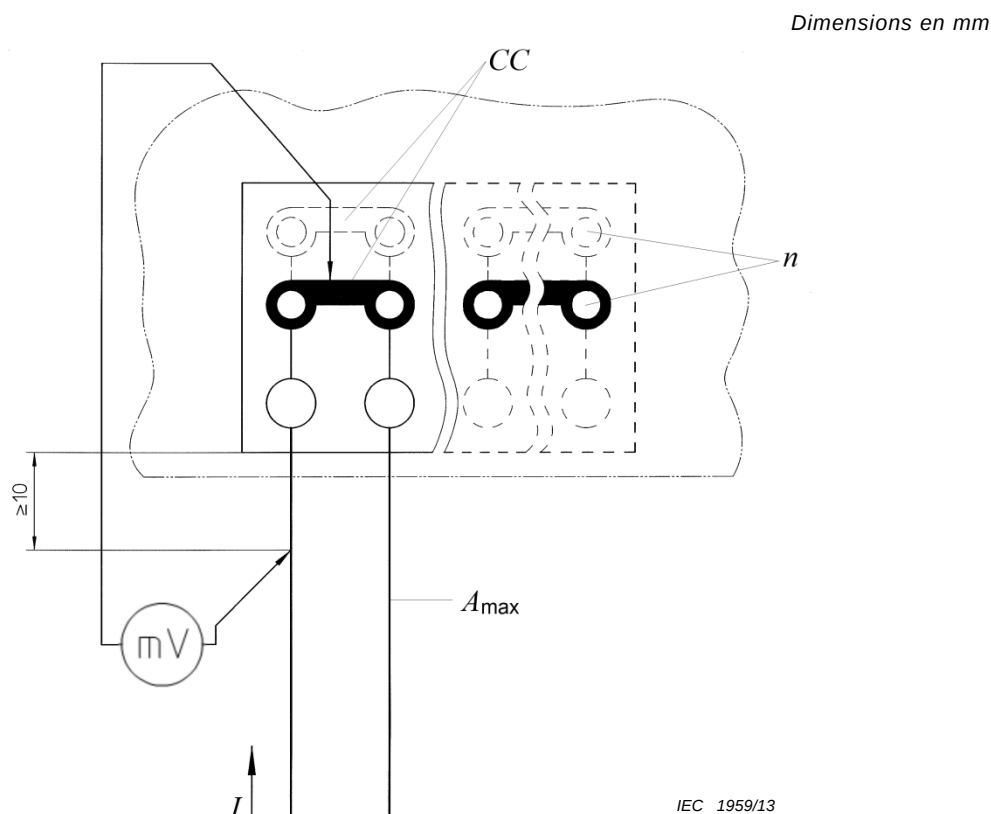
Cet essai a pour objet de vérifier la capacité de tenue au choc thermique.

L'essai est effectué sur deux unités de contact adjacentes avec les chemins du courant les plus longs et les plus défavorables, d'un bloc de jonction pour carte de circuits imprimés ou de deux blocs adjacents. Pour cet essai, le bloc de jonction pour carte de circuits imprimés est monté comme en utilisation normale selon les instructions du fabricant et connecté avec des conducteurs de section maximale $A_{\max}$ et des interconnexions A_B comme déterminé en 8.4.5 (voir Figure 3).

Le couple de serrage pour les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés avec organes de serrage à vis doit être conforme au Tableau 4 de la CEI 60947-1:2007 ou en variante à une valeur plus élevée, comme spécifié par le fabricant.

A la fin de l'essai, le montage (circuit) d'essai ne doit présenter aucune interruption et les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés doivent être exempts de craquelures, cassures ou autre dommage critique.

Après refroidissement à la température ambiante, les unités de contact doivent satisfaire à l'essai de résistance de contact selon 8.4.4.



Légende

I	Courant d'essai
mV	Voltmètre
n	Nombre de connexions à la carte de circuits imprimés par unité de contact
CC	Piste sur la carte de circuits imprimés en vue d'une interconnexion
$A_{\max}$	Section maximale en mm ²

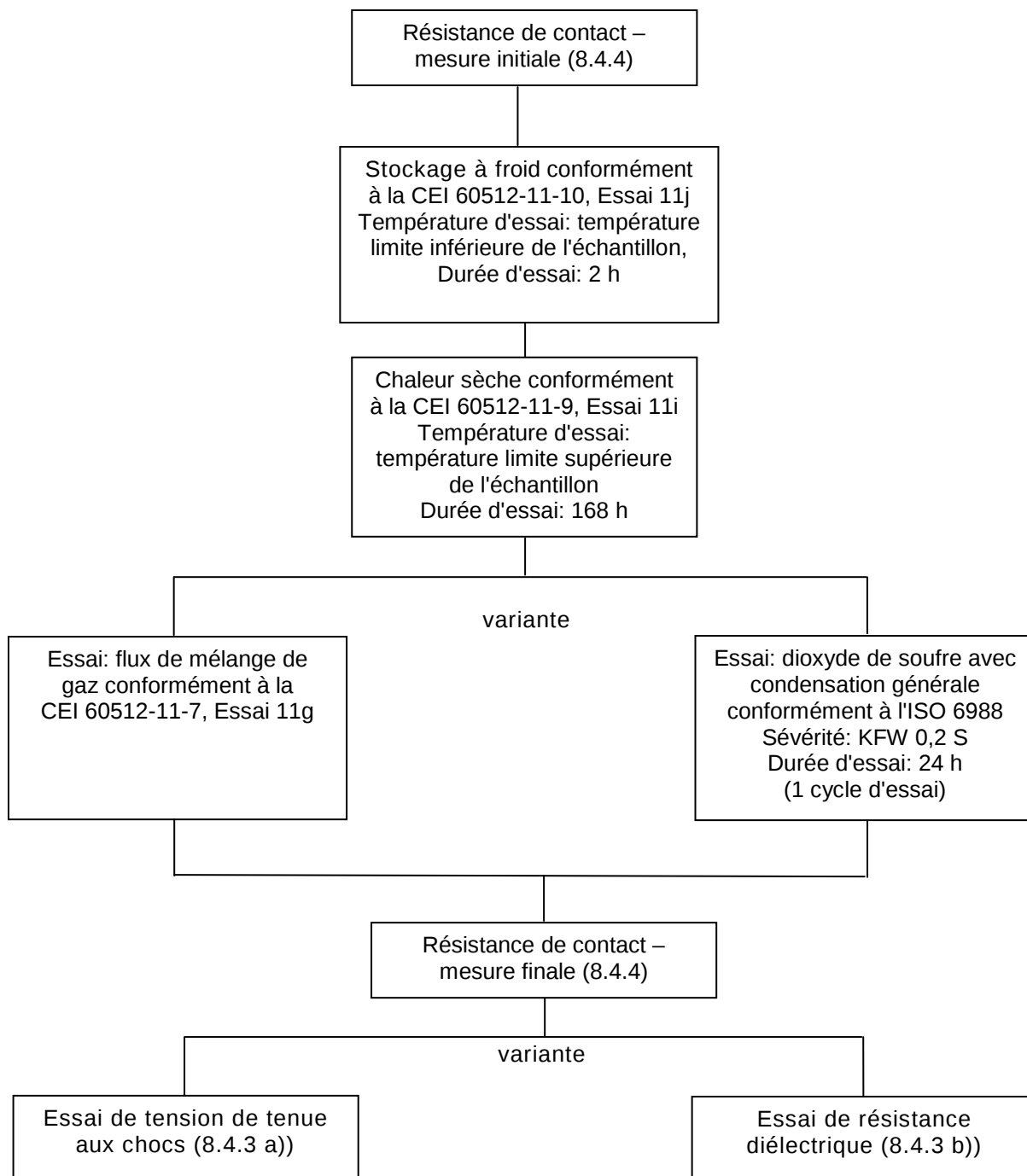
Figure 3 – Montage d'essai pour la mesure du courant de courte durée admissible

8.4.7 Essai de vieillissement (séquence climatique et essai de corrosion)

Cet essai a pour objet de vérifier que les organes de serrage et les connexions à la carte de circuits imprimés sont capables de résister aux conditions d'environnement et au vieillissement.

La séquence d'essai est réalisée sur un lot de blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés, chaque bloc étant connecté avec les conducteurs de sections minimale et maximale. La fixation du bloc de jonction sur la carte de circuits imprimés doit être réalisée selon les instructions du fabricant.

Les essais sont effectués sur des échantillons préparés dans la séquence d'essai indiquée (voir Figure 4).



IEC 1960/13

Figure 4 – Séquence d'essai

Après chaque phase d'essai, sauf après la mesure de la résistance de contact, les échantillons doivent être soumis à une inspection visuelle pour laquelle les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés doivent être exempts de craquelures, cassures ou autre dommage critique.

8.5 Vérification des caractéristiques thermiques

Les caractéristiques thermiques sont vérifiées par l'essai au fil incandescent.

NOTE Les essais ne sont pas effectués sur les pièces de matériau céramique.

L'essai est effectué selon la CEI 60695-2-10 dans les conditions suivantes:

- sur les pièces de matériaux isolants nécessaires au maintien en position des parties conductrices et sur les pièces du circuit du conducteur de protection à une température d'essai de 850 °C;
- sur les pièces de matériaux isolants nécessaires au bon fonctionnement du bloc de jonction pour carte de circuits imprimés à une température d'essai de 650 °C.

Lorsque les essais doivent être effectués en deux points ou plus d'un même échantillon, on doit s'assurer que toute détérioration provoquée par les essais précédents n'affecte pas l'essai à effectuer.

L'essai est effectué sur un seul échantillon. En cas de doute, l'essai doit être répété sur deux autres échantillons qui doivent alors satisfaire à l'essai répété.

L'essai consiste à appliquer le fil incandescent une seule fois pendant 5 s avec une tolérance de – 0/+1 s.

Pendant l'essai, l'échantillon doit être placé dans la position d'utilisation normale la plus défavorable, la surface à soumettre à essai étant en position verticale. L'extrémité du fil incandescent doit être appliquée sur la surface spécifiée de l'échantillon en tenant compte des conditions d'utilisation normale dans lesquelles un objet chauffé ou incandescent peut entrer en contact avec l'échantillon.

L'échantillon d'essai est considéré comme ayant satisfait à l'essai au fil incandescent s'il n'y a ni flamme ni incandescence ou si toutes les situations suivantes s'appliquent:

- a) si les flammes ou l'incandescence du spécimen d'essai disparaissent dans un délai de 30 s suivant le retrait du fil incandescent, c'est-à-dire $t_e \leq t_a + 30$ s; et
- b) si la couche spécifiée de papier mousseline est utilisée, il ne doit pas y avoir d'inflammation du papier en question.

8.6 Vérification des caractéristiques de CEM

8.6.1 Généralités

Le paragraphe 8.4 de la CEI 60947-1:2007 s'applique avec le complément suivant.

8.6.2 Immunité

Les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés couverts par le domaine d'application de la présente norme ne sont pas sensibles aux perturbations électromagnétiques, et par conséquent aucun essai d'immunité n'est nécessaire.

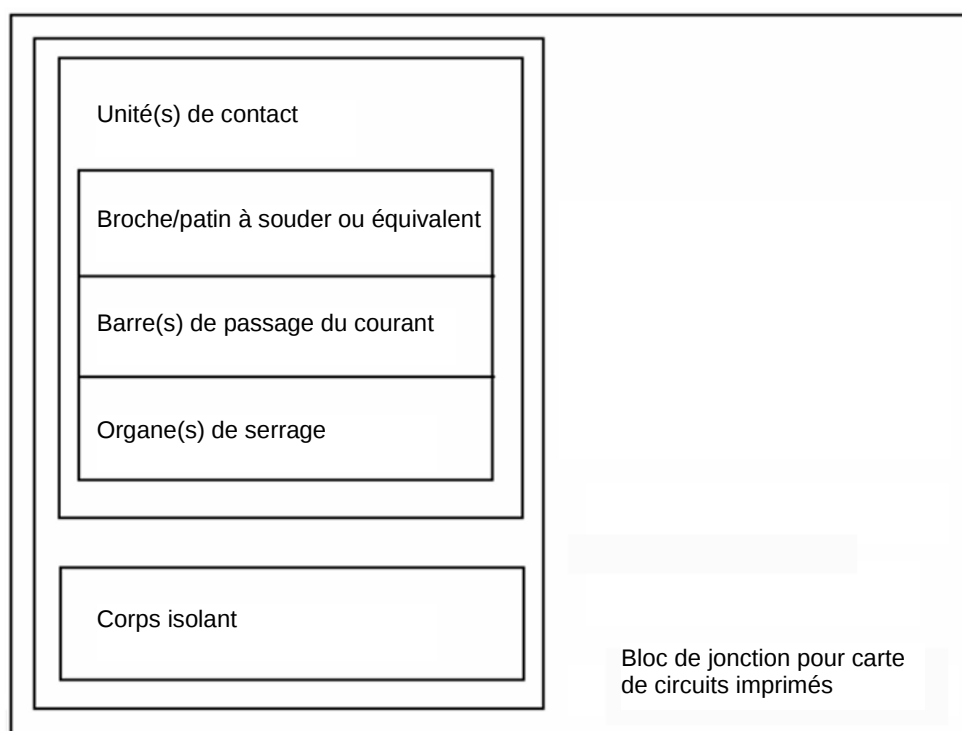
8.6.3 Emission

Les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés couverts par le domaine d'application de la présente norme ne génèrent pas de perturbations électromagnétiques, et par conséquent aucun essai d'émission n'est nécessaire.

Annexe A (informative)

Structure d'un bloc de jonction pour carte de circuits imprimés

La structure d'un bloc de jonction pour carte de circuits imprimés consiste en un corps isolant et une ou plusieurs unités de contact (voir également la Figure A.1).



IEC 1961/13

Figure A.1 – Structure d'un bloc de jonction pour carte de circuits imprimés

Annexe B

(informative)

Informations complémentaires à spécifier entre le fabricant et l'utilisateur

B.1 Informations complémentaires disponibles à la demande de l'utilisateur

Outre les informations sur le produit décrites à l'Article 5, les éléments suivants sont soumis à accord entre le fabricant et l'utilisateur:

- courbes de déclassement supplémentaires selon la CEI 60512-5-2, Essai 5b;
- méthode d'essai d'inflammabilité pour les produits finis selon la CEI 60695-2-11;
- indice d'inflammabilité au fil incandescent (GWFI) des matériaux des blocs de jonction de carte pour circuits imprimés selon la CEI 60695-2-12;
- essai au brûleur-aiguille selon la CEI 60695-11-5;
- essai à la bille selon la CEI 60695-10-2.

NOTE Pour les besoins de la présente Annexe, le terme «accord» est utilisé dans un sens très large et le terme «utilisateur» inclut les stations d'essai.

B.2 Informations pour les essais additionnels à ceux mentionnés ci-dessus

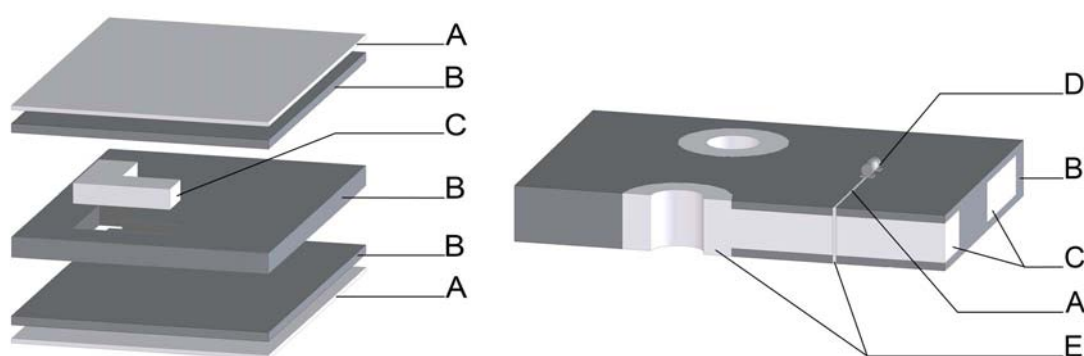
- Groupe des matériaux isolants (valeur de l'IRC, indice de résistance au cheminement) du matériau isolant.
Il est recommandé de vérifier le groupe de matériaux isolants par la valeur de l'ITC (indice de tenue au cheminement).
- Spécification particulière applicable, si disponible, par exemple, température en charge selon l'essai 9e de la CEI 60512-9-5.
- Essais pour les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés classés *T* selon la CEI 60998-1:2002, Article 12.

Annexe C (informative)

Exemples de cartes de circuits imprimés et de blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés pour une application haute intensité

C.1 Disposition des cartes de circuits imprimés haute intensité (schéma de principe)

Les blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés pour une application haute intensité sont habituellement mis en œuvre avec des cartes de circuit imprimé pour courant de haute intensité telles que décrites par la Figure C.1. Les méthodes de connexion sont la soudure et le vissage (voir la Figure C.2 et la Figure C.3).



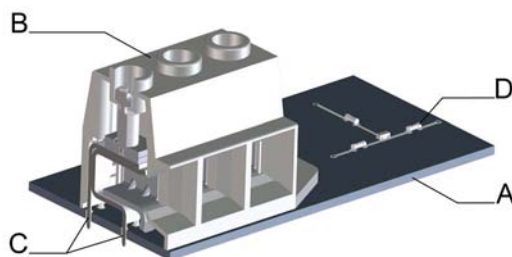
IEC 1962/13

Légende

- A couche conductrice
- B matériau de base
- C incrustation de parties conductrices
- D composant CMS
- E connexion transversale

Figure C.1 – Structure d'une carte de circuits imprimés haute intensité

C.2 Blocs de jonction pour cartes de circuits imprimés haute intensité

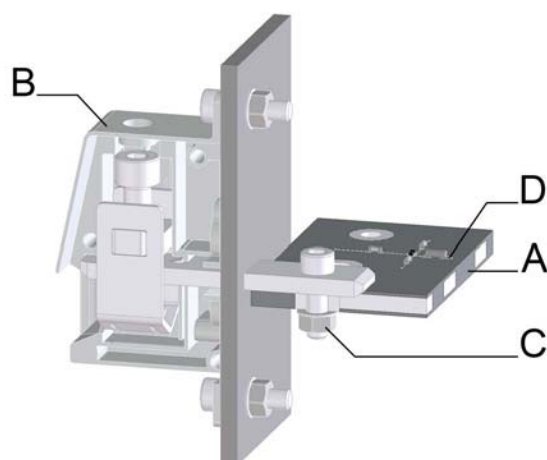


IEC 1963/13

Légende

- A carte de circuits imprimés
- B bloc de jonction pour carte de circuits imprimés
- C connexion selon 7.1.2
- D composant CMS

Figure C.2 – Bloc de jonction pour carte de circuits imprimés avec connexion soudée à ladite carte



IEC 1964/13

Légende

- A carte de circuits imprimés
- B bloc de jonction pour carte de circuits imprimés
- C connexion selon 7.1.2
- D composant CMS

**Figure C.3 – Bloc de jonction pour carte de circuits imprimés
avec connexion vissée à ladite carte**

Bibliographie

CEI 60512-5-1, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 5-1: Essai de courant limite – Essai 5a: Echauffement*

CEI 60512-9-5, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 9-5: Essais d'endurance – Essai 9e: Charge en courant, essai cyclique*

CEI 60529, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)*

CEI 60664-1:2007, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, exigences et essais*

CEI 60695-2-11, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-11: Essais au fil incandescent / chauffant – Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis*

CEI 60695-10-2, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 10-2: Chaleurs anormales – Essai à la bille*

CEI 60695-11-5, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-5: Flammes d'essai – Méthode d'essai au brûleur-aiguille – Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes directrices*

CEI 60998-1:2002, *Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue – Partie 1: Règles générales*

CEI 61984, *Connecteurs – Exigences de sécurité et essais*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch